

股票简称：安集科技

股票代码：688019

安集微电子科技（上海）股份有限公司

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.

上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层



向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要

保荐人（主承销商）



新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二五年四月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定，并同意委托申万宏源承销保荐担任受托管理人。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书摘要正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券业经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，安集科技主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有

的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。

三、公司本次可转换公司债券不提供担保

本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向上的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（二）客户集中度较高风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

（三）原材料供应及价格上涨风险

目前公司生产所需的部分主要原材料采购来源以进口为主。2021 年度、2022

年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（四）存货管理风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司采用上线结算方式的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3,626.81 万元、4,739.01 万元、3,177.07 万元和 3,396.90 万元，占存货账面余额的比例分别为 15.66%、12.80%、7.32%和 6.69%。公司已与采用上线结算方式的客户约定发出商品的管理机制和保管、灭失等风险承担机制，但若双方对保管责任的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品面临减值的风险。

（五）半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。近年来，全球公共卫生事件、高通胀以及局部地区冲突等因素给宏观经济带来负面影响，加上智能手机、个人电脑等消费性电子市场需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度开始进入本轮下行周期。根据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导体市场规模受通胀加剧、终端市场需求疲软等负面因素影响下降 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导

体行业复苏不及预期或者市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

（六）汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为 580.71 万元、-3,171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（七）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险

当前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

（八）募投项目实施风险

公司本次募投项目建设内容既包括提升刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现有产品品类生产规模，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等产品品类横向拓宽并向纳米磨料、电子级添加剂等上游关键原材料领域纵向延伸，还包括通过自动化信息化建设和研发设备购置进一步提升公司生产制造和技术研发水平。如果本次募投项目建成后规模化生产的产品品质不及预期，无法顺利通过下游客户验证或者验证通过后具体订单规模受下游客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期，将影响本次募投产品的销售，进而对募投项目效益实现带来不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平下降的风险。

此外，本次募集资金到位后，公司将同时实施多个募投项目，对公司的管理能力、技术实力、人员储备、资源配置、市场拓展和法律及财务风险管理等各方

面能力提出了更高的要求，若公司在管理、技术、人员或资源等方面达不到募投项目实施要求或出现不利变化，则募投项目存在不能按原定计划实施完成的风险。

（九）募投项目新增产能消化的风险

公司产品研发验证门槛高，从研发立项到实现量产销售需要经过较长的周期，而实现量产销售后具体产品的销售增长情况受下游客户相应工艺产能及产量影响。公司本次募投项目新增产品产能主要根据下游客户产线需求及未来增长情况合理规划，新增关键原材料产能主要根据公司生产产品对应原材料自用量合理规划。如果募投项目投产后，公司下游客户需求发生不利变化，可能导致公司无法有效开拓市场以消化募投项目新增产能，进而导致募投项目无法实现预期收益。

（十）本次可转债的本息兑付风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化，故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法按时足额兑付的风险。

（十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险

对于投资者而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股价格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。

对于公司而言，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

五、关于填补即期回报的措施和承诺

（一）关于填补摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的

风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、加大产品研发和市场拓展力度，提升公司市场地位和盈利能力

公司将加大产品研发和市场拓展力度，不断提升公司的市场地位和盈利能力，一方面公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务；另一方面，公司将积极进行市场开拓，加强客户拓展，加快产品的测试论证及销售放量。

2、提升公司经营管理水平，完善公司治理结构

公司将改进完善业务流程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各环节的管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

3、积极稳妥推进募投项目建设，争取早日实现预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金运用效率，争取募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

4、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定以及公司《募集资金管理使用制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

5、严格执行分红政策，强化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，增加利润分配决策透明度、更好的回报投资者，维护股东利益，公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求在《公司章程》中制定了利润分配相关条款，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。同时，公司已制定《安集微电子科技（上海）股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行股东回报政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升股东回报水平。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司相关主体对本次发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、控股股东的承诺

（1）本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

2、董事、高级管理人员的承诺

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日后至本次不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

目录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险.....	2
三、公司本次可转换公司债券不提供担保.....	3
四、特别风险提示.....	3
五、关于填补即期回报的措施和承诺.....	6
目 录.....	10
第一节 释义	12
一、一般释义.....	12
二、专业释义.....	13
第二节 本次发行概况	17
一、公司基本情况.....	17
二、本次发行概况.....	17
三、本次发行可转债的基本条款.....	23
四、本次发行的相关机构.....	34
五、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	35
第三节 发行人基本情况	37
一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况.....	37
二、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况.....	37
三、重要承诺及其履行情况.....	38
第四节 财务会计信息与管理层分析	41
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....	41
二、财务报表.....	41
三、主要财务指标.....	48
四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.....	50
五、财务状况分析.....	56

六、经营成果分析.....	78
七、现金流量分析.....	88
八、资本性支出分析.....	91
九、技术创新分析.....	91
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	91
十一、本次发行的影响.....	91
第五节 本次募集资金运用	93
一、本次募集资金的使用计划.....	93
二、本次募集资金投资项目实施的必要性与可行性分析.....	93
三、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景.....	98
四、本次募集资金用于拓展新业务、新产品的说明.....	106
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	108
六、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司 科技创新水平提升的方式.....	108
第六节 备查文件	110

第一节 释义

除另有说明，以下简称在本募集说明书摘要中含义如下：

一、一般释义

安集科技、公司、本公司、发行人	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司
本次发行	指	公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
Anji Cayman	指	Anji Microelectronics Co. Ltd.，公司控股股东
上海安集	指	安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司
宁波安集	指	宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
台湾安集	指	台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
宁波安集投资	指	宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司
北京安集	指	北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
安集电子材料	指	上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司
新加坡安集	指	ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全资子公司
CORDOUAN	指	CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司
SEPPURE	指	SEPPURE PTE. LTD.
青岛聚源	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
安特纳米	指	山东安特纳米材料有限公司
钥熠电子	指	上海钥熠电子科技有限公司
硅研电子	指	河北硅研电子材料有限公司
湖北三维创新中心	指	湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司
芯链融创	指	芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司
嘉兴红晔	指	嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥溯慈	指	合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙）
石溪产恒二期	指	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）
徐州盛芯	指	徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
聚源振芯	指	苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）
中科同芯	指	广州中科同芯半导体技术合伙企业（有限合伙）
天德合享	指	上海天德合享企业管理服务合伙企业（有限合伙）

长存产业基金	指	长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商、受托管理人、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所、毕马威	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
报告期、最近三年一期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

化学机械抛光（CMP）	指	Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP技术由化学作用和机械作用两方面协同完成。
化学机械抛光液、抛光液、研磨液	指	由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过程中使用的主要化学材料。
研磨颗粒、纳米磨料	指	为生产化学机械抛光液所需的关键原材料，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等品类。
清洗技术	指	通过化学处理、气体或物理方法去除晶片表面杂质的过程。通常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一道工序所遗留的超微细颗粒污染物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜或残留，也可根据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好良好的表面条件。晶圆清洗步骤数量约占所有芯片制造工序步骤30%以上，而且随着节点的推进，清洗工序的数量和重要性会继续提升。根据清洗介质的不同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线，晶圆制造产线上通常以湿法清洗为主。

湿法清洗	指	针对不同的工艺需求，采用特定的化学药液和去离子水，对晶圆表面进行无损伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、自然氧化层、有机物、金属污染、牺牲层、抛光残留物等物质，可同时采用超声波、加热、真空等辅助技术手段。
湿电子化学品、工艺化学品	指	是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。
光刻	指	半导体器件制造工艺中的一个重要步骤，该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底上。
光刻胶	指	光刻中采用的感光物质，其利用光照反应后溶解度不同将掩模版图形转移至衬底上。
光刻胶去除	指	刻蚀过程中光刻胶定义的图像被转移到晶圆表面并且刻蚀到定义的深度，刻蚀之后作为刻蚀保护层或者阻挡层的剩余光刻胶需要从晶圆表面去除。
光刻胶去除剂、光阻去除剂	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶片，去除半导体晶片上的光刻胶及其光刻胶刻蚀后残留物。
刻蚀后清洗液	指	一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆表面残留物去除。
光刻胶剥离液	指	一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装以及部分集成电路工艺。
半导体电镀、电化学沉积	指	在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆表面形成金属互连。
电镀基础液	指	提供电沉积金属离子，与电镀液添加剂相互作用，在电场作用下实现金属电化学沉积。
电镀液添加剂	指	电镀工艺核心材料，改善镀层性能及电镀质量。在电镀工艺中，电镀液添加剂与基础液相互作用，在电场作用下实现金属电化学沉积。
刻蚀	指	用化学或物理方法有选择地从硅片表面去除不需要的材料的过程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的方式去除硅片表面的材料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或结合物理、化学两种反应）的方式将表面材料去除。
芯片、集成电路（IC）	指	Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。通过氧化、光刻、扩散、外延、蒸镀、表面处理等制造工艺，把电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。
制程、节点、特征线宽	指	晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。尺寸越小，表明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、7nm等等。
逻辑芯片	指	一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。
存储芯片	指	又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。
模拟芯片	指	主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的芯片类型。

DRAM	指	动态随机存取存储器，属于易失性存储器。
NAND	指	闪存，属于非易失性存储器。
2D NAND	指	存储单元为平面结构的一种NAND存储器。
3D NAND	指	一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一起来解决2D或者平面NAND闪存带来的限制。
晶圆（wafer）	指	集成电路制作所用到的基材料，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。
传统封装	指	先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形式。
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴。先进封装四大要素分别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气延伸的作用，TSV起到Z轴电气延伸的作用，Bump起到界面互联和应力缓冲的作用，Wafer作为集成电路的载体以及RDL和TSV的介质和载体。
晶圆级封装（WLP）	指	Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装。这种方案可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子产品、高端超级计算、游戏、人工智能和物联网设备的多晶片封装提供了更广泛的形状系数。
三维集成	指	将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连实现多层之间的电信号连接的技术，TSV是三维集成技术的实现方法之一。
凸块（Bumping）技术	指	在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，广泛应用于FC（倒装）、WLP（晶圆级封装）、CSP（芯片级封装）、3D（三维立体封装）、（SiP）系统级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等环节而成，该技术是晶圆制造环节的延伸，也是实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。相比以引线作为键合方式传统的封装，凸块代替了原有的引线，实现了“以点代线”的突破。该技术可允许芯片拥有更高的端口密度，缩短了信号传输路径，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠性。此外，将晶圆重布线技术（RDL）和凸块制造技术相结合，可对原来设计的集成电路线路接点位置进行优化和调整，使集成电路能适用于不同的封装形式，封装后芯片的电性能可以明显提高。
重布线层（RDL）技术	指	Redistribution Layer，起着XY平面电气延伸和互连的作用。RDL技术的核心是在晶圆表面沉积金属层和介质层并形成相应的金属布线图形，对芯片的I/O端口进行重新布局，根据后续封装工艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵列排布。随着工艺技术的发展，通过RDL形成的金属布线的线宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。目前RDL技术多采用电化学沉积的方式来完成。

小芯片组、芯粒（Chiplet）技术	指	在同一个封装或系统里集成多个裸片的一种新型芯片设计模式。
硅通孔（TSV）技术	指	Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通，实现芯片之间互连的新的技术解决方案。TSV技术能够使芯片在三维方向堆叠的密度最大，芯片之间的互连线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速度和低功耗的性能。
铜阻挡层	指	集成电路后道铜导线和绝缘介质中间的一种阻挡层材料，目的是防止铜和绝缘介质发生反应。
鳍式场效应晶体管（FinFET）	指	Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管，FinFET命名是根据晶体管的形状与鱼鳍非常相似。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流，也可以大幅缩短晶体管的闸长。
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
超越摩尔	指	当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不能沿用原来的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只能通过引入更加创新的三维集成来提升芯片性能，包括革命性的新材料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。
后道工艺	指	半导体芯片制造工艺流程中比较靠后的对晶体管进行导线连接的工艺步骤，如铜互连、金属退火等。
前道工艺	指	半导体芯片制造工艺流程中比较靠前的对晶体管性能进行控制的工艺步骤，如栅极光刻技术、离子注入技术等。
平坦化	指	在制造工艺中，通过热流程、有机层或化学机械抛光技术对晶圆表面的平整化。
铜制程、铜互连技术	指	在半导体集成电路互连层的制作中采用铜金属材料取代传统铝金属互连材料的半导体制造工艺技术。铜互连工艺具有更低的电阻率、抗电迁移性，能够满足芯片尺寸更小、功能更强大、能耗更低的技术性要求。
大马士革工艺	指	衍生自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻技术，先在介电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，特点是不需要进行金属层的刻蚀。
导体	指	具有低电阻和高电导率的材料。
介电材料	指	属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击穿等现象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料通常指二氧化硅、氮化硅等绝缘材料。
浅槽隔离（STI）	指	即Shallow-Trench Isolation。通常用于0.25μm以下工艺，通过使用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中填充淀积氧化物，用于与硅隔离。
宽禁带半导体、第三代半导体	指	使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓等）的半导体器件。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会。
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。
SIA	指	Semiconductor Industry Association，美国半导体产业协会。
TECHCET	指	一家全球知名的电子材料咨询公司。
Yole	指	Yole Intelligence，一家全球知名的半导体咨询机构。

注：本募集说明书摘要中若各分项数值直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称	安集微电子科技（上海）股份有限公司
英文名称	Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.
注册地	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6—9 幢底层
证券简称	安集科技
证券代码	688019
上市地	上海证券交易所

二、本次发行概况

（一）本次发行的背景与目的

1、本次发行的背景

（1）半导体产业是全球战略竞争的制高点，材料是半导体产业的重要支撑，在全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等不确定因素下，提升半导体材料产业链自主可控供应能力至关重要

半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，已经成为全球各国在高科技竞争中的战略制高点，全球主要国家和地区相继出台半导体产业扶持政策。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石和推动集成电路技术创新的引擎，对半导体产业发展起着重要支撑作用。

由于技术壁垒高、国内起步较晚，目前全球半导体材料供应链依然由日本、欧美等海外企业占据绝对主导地位，而国内半导体材料整体国产化率较低，特别是 12 英寸高端领域国产替代需求极为迫切。在当前半导体产业环境和国际形势下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增加了半导体供应链的不确定性，供应链安全成为本土晶圆厂重要考量因素，而关键半导体材料的影响极其深远。因此，公司亟需通过本次募集资金投资项目的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延伸产业链，及时把握集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的良好机遇，同时助力进一步提升关键材料国产化水平并形成自主

可控的集成电路产业体系。

（2）借助上海化工区显著的区位和配套优势，以上海电子化学品专区揭牌成立为契机，打造公司生产制造基地差异化布局和协同发展，助力公司产品战略的实施和多元化布局

公司现有两个生产制造基地，分别位于公司租赁的上海金桥基地和全资子公司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要生产化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；得益于地处综合保税区内，上海金桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和优势。宁波北仑基地于 2020 年建成投产，是公司首个自购自建并根据公司产品量身打造的生产制造基地，主要生产功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的有效拓展及补充；出于供应安全考量，宁波安集正在建设公司化学机械抛光液第二生产基地。

上海化工区是全国七大石化产业基地之一，国家级经济技术开发区，是全国集聚知名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环保管理严格、循环经济水平领先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有显著的区位和配套优势，能够为公司的稳定生产供应提供保障。2020 年 12 月，上海化工区电子化学品专区揭牌成立，重点发展光刻胶及配套材料、电子特气、湿电子化学品等三大类产品，打造电子化学品研发试验基地、生产基地、物流存储基地。到 2025 年，力争专区各类产品为上海集成电路产业的电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，实现本土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率超过 90%，成为具有国际影响力的电子化学品基地。

公司作为首批签约投资单位，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募投项目“上海安集集成电路材料基地项目”建设公司上海化工区基地，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、生产、质量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，并且具有化工产品生产的条件和资质，满足了公司进一步拓展产品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北仑基地共同实现公司三大生产制造基地差异化布局和协同发展，助力公司产品战略的实施和多元化布局，同时满足了客户关于供应商应设立多个生产基地以规避风险的要求，对于确保产业链供应链稳定具有重要意义。

（3）进一步拓宽产品品类，加强公司核心原材料的自主可控，提升公司产品的竞争力和自主供应能力，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的关键半导体材料

公司始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化学品配方核心技术并持续专注投入，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品类产品线的布局，为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案；报告期内，公司在自有技术持续数年开发的基础上，通过国际技术合作的形式，完善和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及知识产权为本，始终围绕自身的核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及一站式的解决方案。同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司通过自建、合作等多种方式，持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，优化产品性能及成本结构，提升产品竞争力，保障长期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新产品的技术可行性。

本次募投项目建成后，一方面，将新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等产品产能，公司将在现有产品系列基础上进一步拓宽产品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的关键半导体材料，有助于支持和保障国内集成电路产业链发展及供应链稳定；另一方面，将新增高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等关键原材料产能，以实现公司核心原材料的自主可控供应，有助于提升公司产品供应的可靠性和竞争力。

2、本次发行的目的

公司本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略，是公司紧抓行业发展机遇，增强核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。本次募集资金投资项目的顺利实施，将加强公司产品及上游关键原料的供应能力，拓宽供应品类，保障供应安全，并提升公司生产制造和技术研发水平，有助于扩大公司市场份额，

巩固并提升公司行业地位，从而进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

（二）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市。

（三）发行规模

本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 83,050.00 万元，发行数量 830,500 手（8,305,000 张）。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（五）预计募集资金量及募集资金净额

本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额为人民币 83,050.00 万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为 81,660.89 万元。

（六）募集资金专项存储的账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（七）募集资金投向

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 83,050.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	上海安集集成电路材料基地项目	38,000.00	34,850.00
2	上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	9,000.00	9,000.00
3	宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目	8,000.00	6,000.00
4	安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	11,000.00	11,000.00
5	补充流动资金	24,000.00	22,200.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
	合计	90,000.00	83,050.00

注 1：上述拟使用募集资金投入金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 1,800.00 万元；

注 2：本次募投项目“上海安集集成电路材料基地项目”中刻蚀液生产线拟使用自有资金投资建设，不涉及使用本次募集资金。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（八）发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

2、发行对象

向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。

本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

（九）承销方式及承销期

1、承销方式

本次向不特定对象发行可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，本次发行认购金额不足 83,050 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 83,050 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

2、承销期

承销期的起止时间：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日。

（十）发行费用

本次发行费用总额预计为 1,389.11 万元，具体包括：

单位：万元

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	989.00
律师费用	107.98
会计师费用	155.88
资信评级费用	55.00
信息披露及发行手续费等	81.25
合计	1,389.11

注：以上费用均为含税金额（发行人为出口加工区免税企业，无法抵扣上述发行费用中的增值税）。

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排
2025 年 4 月 2 日（T-2 日）	披露《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》

日期	发行安排
2025 年 4 月 3 日（T-1 日）	网上路演；原股东优先配售股权登记日
2025 年 4 月 7 日（T 日）	披露《可转债发行提示性公告》、原股东优先配售（缴付足额资金）、网上申购（无需缴付申购资金）、确定网上中签率
2025 年 4 月 8 日（T+1 日）	披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》、网上申购摇号抽签
2025 年 4 月 9 日（T+2 日）	披露《网上中签结果公告》、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（须确保资金账户在 T+2 日日终有足够的认购资金）
2025 年 4 月 10 日（T+3 日）	保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2025 年 4 月 11 日（T+4 日）	披露《发行结果公告》

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

本次申请向不特定对象发行的可转债将在上海证券交易所上市。

（十二）本次发行证券的上市流通安排

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体时间将另行公告。

（十三）投资者持有期的限制或承诺

本次发行的证券不设持有期限限制。

三、本次发行可转债的基本条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日（T 日）至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）面值

每张面值为人民币 100.00 元。

（三）利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年

1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（四）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券业经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，安集科技主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照相关法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所授予的其作为公司债权人的其他权

利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

- （1）拟变更《募集说明书》的约定；
- （2）拟修改本次可转债持有人会议规则；
- （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- （4）公司不能按期支付本次可转债本息；
- （5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- （7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- （8）公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- （9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- （10）公司提出债务重组方案的；
- （11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

（4）相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他机构或人士。

5、债券持有人会议的表决、决议及会议记录

（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，

并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

- 1) 债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
- 2) 上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人、计票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

（8）除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有未偿还债券面值总额的二分之一以上同意方为有效。

（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

1) 如该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法

律约束力；

2) 如该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

(10) 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数，出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转换公司债券张数及占本次可转换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容以及相关监管部门要求的内容。

(11) 债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

1) 召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

2) 会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名；

3) 出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例；

4) 对每一拟审议事项的发言要点；

5) 每一表决事项的表决结果；

6) 债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容；

7) 法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

(12) 会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人(或其委托的代表)、债券受托管理人代表、见证律师、记录员、计票人和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。

（13）召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（14）公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

（七）转股价格调整的原则及方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 168.11 元，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（八）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十一）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

（十二）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其

持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

四、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：	安集微电子科技（上海）股份有限公司
法定代表人：	Shumin Wang
住所：	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6—9 幢底层
董事会秘书	杨逊
联系电话：	021-20693201
传真号码：	021-50801110

（二）保荐人、主承销商、受托管理人

名称：	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：	王明希
住所：	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
保荐代表人：	康杰、包建祥
项目协办人：	张晟宇
项目组其他成员：	周毅、刘德法、刘希、袁圣杰
电话：	021-33389725
传真：	021-33389700

（三）律师事务所

名称：	上海市锦天城律师事务所
机构负责人：	沈国权
住所：	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
经办律师：	胡家军、严杰、彭思佳
电话：	021-20511000
传真：	021-20511999

（四）会计师事务所

名称：	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
-----	---------------------

机构负责人:	邹俊
住所:	北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层
经办注册会计师:	徐海峰、黄晓冬、杨洁
电话:	010-85085000
传真:	010-85185111

（五）申请上市的证券交易所

名称:	上海证券交易所
住所:	上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话:	021-68808888
传真:	021-68804868

（六）资信评级机构

名称:	联合资信评估股份有限公司
法定代表人:	王少波
住所:	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
经办评级师:	王佳晨子、王玥
电话:	010-85679696
传真:	010-85679228

（七）保荐人（主承销商）收款银行

开户银行:	中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
户名:	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
账号:	0200291409200028601

（八）登记结算公司

名称:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:	上海市浦东新区杨高南路 188 号
电话:	021-68670204
传真:	021-68670204

五、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股

权关系或其他权益关系。

第三节 发行人基本情况

一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司股本总数为 128,754,740 股，其中公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	股东性质
1	Anji Microelectronics Co. Ltd.	39,810,936	30.92	0	其他
2	香港中央结算有限公司	6,523,607	5.07	0	其他
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5,151,663	4.00	0	国有法人
4	上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	3,225,326	2.51	0	其他
5	景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	2,786,424	2.16	0	其他
6	上海大辰科技投资有限公司	2,307,002	1.79	0	境内非国有法人
7	中国建设银行股份有限公司—景顺长城研究精选股票型证券投资基金	1,623,693	1.26	0	其他
8	国泰君安证券股份有限公司	1,262,801	0.98	0	国有法人
9	宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	1,258,581	0.98	0	其他
10	国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,217,129	0.95	0	其他
合计		65,167,162	50.61	0	-

二、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况

截至 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 持有公司 39,810,936 股股份，占公司股份总数的 30.92%，为公司控股股东，公司无实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

截至 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况，除直接控制公司并间接控制公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下：

企业名称	Anji Microelectronics Co. Ltd.		
登记证书编号	CR-137213		
成立日期	2004 年 6 月 23 日		
发行股数	76,869,099 股		
住所	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands		
主要业务、主要资产的规模及分布	Anji Cayman 为一家投资控股型公司，不实际从事生产经营业务，其主要资产为持有发行人股份。		
2023 年度财务数据 (万美元)	总资产	净资产	净利润
	1,106.62	1,106.62	11,250.94

注：以上财务数据未经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Yuding Limited	14,127,803	18.38
2	Northern Light Venture Fund II, L.P.	13,020,308	16.94
3	Northern Light Strategic Fund II, L.P.	1,701,019	2.21
4	Northern Light Partners Fund II, L.P.	160,726	0.21
5	Oriental Wall Limited	11,927,154	15.52
6	SGB Holdings Inc.	4,015,271	5.22
7	CRS Holdings Inc.	5,043,255	6.56
8	SMS Global Holdings Inc.	4,059,833	5.28
9	RUYI Holdings Inc.	20,582,265	26.78
10	Anjoin Company Limited	2,231,465	2.90
合计		76,869,099	100.00

三、重要承诺及其履行情况

（一）本次发行前发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

本次发行前发行人及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人已于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书摘要签署日，相关主体所作出的公开承诺履行情况正常，不存在违反承诺的情形。

（二）与本次发行相关的承诺事项

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

1、公司控股股东承诺

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出承诺如下：

“（1）本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。”

2、公司董事、高级管理人员承诺

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日后至本次不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”

第四节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报告及公司披露的未经审计的 2024 年半年度报告。

公司提示投资者关注募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第 2405139 号”无保留意见的审计报告。发行人 2024 年 1-6 月的财务报告未经审计。

（二）重要性水平

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占利润总额的比重是否超过 5%。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	645,720,763.92	532,005,482.71	329,320,880.74	332,630,820.87
交易性金融资产	34,471,137.30	61,131,418.62	168,717,686.33	219,375,703.18

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
衍生金融资产	-	188,768.24	-	1,009,512.18
应收票据	444,118.71	218,985.72	1,930,462.27	1,355,948.79
应收账款	349,025,228.53	281,788,622.28	235,641,650.88	176,730,269.50
预付款项	47,477,013.74	27,551,560.96	29,054,424.28	10,920,025.66
其他应收款	2,361,491.58	1,308,312.00	1,211,142.56	883,974.74
其中：应收利息	-	-	-	14,530.01
存货	501,901,840.78	427,210,703.01	365,899,049.91	230,421,740.95
其他流动资产	16,091,406.14	10,903,008.59	14,190,717.02	22,602,111.01
流动资产合计	1,597,493,000.70	1,342,306,862.13	1,145,966,013.99	995,930,106.88
非流动资产：				
长期股权投资	109,338,848.17	112,014,542.92	74,244,349.93	39,705,613.95
其他权益工具投资	62,006,555.26	62,800,000.00	36,831,732.13	9,000,000.00
其他非流动金融资产	138,716,643.96	139,300,000.00	97,861,688.58	51,815,152.00
固定资产	455,991,765.67	308,698,902.10	241,616,622.32	255,013,538.22
在建工程	135,950,437.88	178,709,923.75	192,455,548.41	111,440,151.45
使用权资产	87,115,134.16	96,176,370.76	109,363,307.57	137,040,204.69
无形资产	78,816,339.75	80,226,705.07	33,756,402.72	12,250,296.67
商誉	7,389,535.80	7,389,535.80	-	-
长期待摊费用	142,679,552.01	134,922,380.04	16,676,707.19	11,030,402.53
递延所得税资产	48,787,284.18	44,345,666.38	45,232,755.36	41,715,444.01
其他非流动资产	135,330,807.42	96,510,206.78	53,596,165.87	7,287,529.54
非流动资产合计	1,402,122,904.26	1,261,094,233.60	901,635,280.08	676,298,333.06
资产总计	2,999,615,904.96	2,603,401,095.73	2,047,601,294.07	1,672,228,439.94

(续上表)

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：				
短期借款	9,868,127.19	9,868,127.19	30,026,666.67	15,886,009.33
应付账款	174,817,527.72	80,504,731.85	85,721,130.84	80,792,931.68
合同负债	16,918,871.27	7,067,294.81	273,230.00	248,840.00
应付职工薪酬	25,858,218.95	28,197,835.89	26,402,395.61	13,951,074.33

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：				
应交税费	11,655,901.84	6,263,725.83	22,709,978.55	22,701,159.26
其他应付款	61,475,712.40	29,395,527.68	187,645,697.03	171,630,954.32
一年内到期的非流动负债	33,894,746.23	31,667,346.16	24,063,937.98	26,986,021.36
流动负债合计	334,489,105.60	192,964,589.41	376,843,036.68	332,196,990.28
非流动负债：				
长期借款	147,820,039.96	94,590,606.24	29,900,000.00	-
租赁负债	73,292,561.42	82,851,579.32	98,963,053.48	116,895,173.94
递延收益	91,149,622.75	102,028,148.72	18,508,781.95	21,975,340.39
递延所得税负债	4,581,844.04	6,921,085.66	1,836,477.58	-
非流动负债合计	316,844,068.17	286,391,419.94	149,208,313.01	138,870,514.33
负债合计	651,333,173.77	479,356,009.35	526,051,349.69	471,067,504.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,754,740.00	99,070,448.00	74,701,640.00	53,220,580.00
资本公积	1,014,362,441.69	1,018,501,340.87	791,588,445.62	779,522,151.14
减：库存股	19,748,941.44	-19,748,941.44	-	-
其他综合收益	2,058,107.88	2,730,022.95	2,592,241.06	210,180.17
盈余公积	49,535,224.00	49,535,224.00	37,350,820.00	26,610,290.00
未分配利润	1,173,321,159.06	973,956,992.00	615,316,797.70	341,597,734.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,348,282,731.19	2,124,045,086.38	1,521,549,944.38	1,201,160,935.33
所有者权益合计	2,348,282,731.19	2,124,045,086.38	1,521,549,944.38	1,201,160,935.33
负债和所有者权益合计	2,999,615,904.96	2,603,401,095.73	2,047,601,294.07	1,672,228,439.94

（二）合并利润表

单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	797,273,450.87	1,237,871,129.22	1,076,787,316.10	686,660,621.16
其中：营业收入	797,273,450.87	1,237,871,129.22	1,076,787,316.10	686,660,621.16
二、营业总成本	548,860,165.08	906,265,590.97	731,172,436.83	587,929,872.55
其中：营业成本	337,100,676.74	546,956,870.15	493,061,025.41	335,893,816.30
税金及附加	1,018,441.70	1,460,914.67	1,310,473.03	1,032,974.19

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
销售费用	23,757,945.07	48,181,178.82	34,265,274.69	29,328,602.10
管理费用	50,351,256.13	81,325,712.66	68,506,095.06	60,200,322.72
研发费用	144,565,200.86	236,612,668.95	161,364,582.09	153,107,847.92
财务费用	-7,933,355.42	-8,271,754.28	-27,335,013.45	8,366,309.32
其中：利息费用	4,567,172.40	7,963,824.79	6,731,766.14	3,767,922.28
利息收入	7,119,871.67	8,891,859.41	2,715,290.73	1,571,679.88
加：其他收益	18,703,576.48	104,301,572.64	11,907,903.26	26,473,396.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,843,537.93	5,337,903.70	1,251,256.11	8,858,548.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,243,637.36	8,758,522.28	-10,318,677.59	8,779,991.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,648,471.63	-2,509,812.09	-3,169,547.02	-5,859,245.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,783,120.55	-6,412,397.53	-5,985,804.04	-3,299,516.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-690,889.54	-55,333.00	-259,075.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,598,094.80	440,390,437.71	339,244,676.99	133,424,847.93
加：营业外收入	22,025.63	68,489.79	-	-
减：营业外支出	522,507.75	36,446.99	45,877.65	1,357,181.97
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	250,097,612.68	440,422,480.51	339,198,799.34	132,067,665.96
减：所得税费用	16,101,771.97	37,688,714.01	37,761,840.64	6,983,602.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,995,840.71	402,733,766.50	301,436,958.70	125,084,063.28
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,995,840.71	402,733,766.50	301,436,958.70	125,084,063.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润	233,995,840.71	402,733,766.50	301,436,958.70	125,084,063.28

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
（净亏损以“-”号填列）				
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列）		-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-671,915.07	137,781.89	2,382,060.89	-22,014.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-671,915.07	137,781.89	2,382,060.89	-22,014.66
七、综合收益总额	233,323,925.64	402,871,548.39	303,819,019.59	125,062,048.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,323,925.64	402,871,548.39	303,819,019.59	125,062,048.62
八、每股收益				
（一）基本每股收益	1.82	4.09	3.53	1.81
（二）稀释每股收益	1.82	4.08	3.52	1.81

（三）合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	758,421,697.86	1,261,582,861.49	1,054,619,470.06	593,092,418.58
收到的税费返还	4,359,524.00	10,523,071.86	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,463,770.16	28,677,673.87	21,818,844.82	103,595,742.56
经营活动现金流入小计	778,244,992.02	1,300,783,607.22	1,076,438,314.88	696,688,161.14
购买商品、接受劳务支付的现金	399,527,110.01	685,547,057.18	626,035,832.49	474,267,471.85
支付给职工以及为职工支付的现金	103,200,098.95	168,855,375.58	127,798,572.75	95,493,605.70
支付的各项税费	24,676,638.98	52,110,675.53	41,627,977.81	27,983,989.10
支付其他与经营活动有关的现金	55,547,121.28	58,035,815.40	41,853,815.35	37,837,309.80
经营活动现金流出小计	582,950,969.22	964,548,923.69	837,316,198.40	635,582,376.45
经营活动产生的现金流量净额	195,294,022.80	336,234,683.53	239,122,116.48	61,105,784.69
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收回投资收到的现金	160,000,000.00	478,717,686.33	630,456,339.98	1,396,589,240.81
取得投资收益所收到的现金	525,425.08	8,762,238.92	2,115,951.02	36,709,694.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	140,552.71
收到其他与投资活动有关的现金	7,106,192.38	8,891,859.41	2,715,290.73	5,703,145.21
投资活动现金流入小计	167,631,617.46	496,371,784.66	635,287,581.73	1,439,142,632.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,757,068.05	337,917,840.60	196,286,540.19	241,116,407.90
投资支付的现金	140,000,000.00	429,999,976.00	661,209,426.00	1,230,914,252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	176,030.85	44,270,231.89	34,333,500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	504,500.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	283,437,598.90	812,188,048.49	891,829,466.19	1,472,030,659.90
投资活动产生的现金流量净额	-115,805,981.44	-315,816,263.83	-256,541,884.46	-32,888,026.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,568,767.68	214,252,118.78	8,848,876.92	7,254,898.98
取得借款收到的现金	57,000,000.00	78,003,885.51	60,000,000.00	29,104,150.00
筹资活动现金流入小计	84,568,767.68	292,256,004.29	68,848,876.92	36,359,048.98
偿还债务支付的现金	2,091,598.11	30,257,515.96	15,805,500.00	34,669,243.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,534,052.58	34,310,009.95	17,421,508.38	16,352,117.79
支付其他与筹资活动有关的现金	15,442,960.28	52,765,119.72	29,366,102.44	17,152,503.61
筹资活动现金流出小计	54,068,610.97	117,332,645.63	62,593,110.82	68,173,864.87
筹资活动产生的现金流量净额	30,500,156.71	174,923,358.66	6,255,766.10	-31,814,815.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,246,784.80	3,202,059.57	10,076,385.74	-1,594,565.56

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
五、现金及现金等价物净增加额	114,234,982.87	198,543,837.93	-1,087,616.14	-5,191,623.68
加：期初现金及现金等价物余额	527,563,833.10	329,019,995.17	330,107,611.31	335,299,234.99
六、期末现金及现金等价物余额	641,798,815.97	527,563,833.10	329,019,995.17	330,107,611.31

（四）发行人财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

1、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、合并财务报表范围及变化情况

（1）报告期各期末合并财务报表范围

报告期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：

序号	公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2024.06.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
1	上海安集	是	是	是	是
2	台湾安集	是	是	是	是
3	宁波安集	是	是	是	是
4	宁波安集投资	是	是	是	是
5	北京安集	是	是	是	是
6	安集电子材料	是	是	是	是
7	新加坡安集	是	是	是	否
8	CORDOUAN	是	是	否	否

（2）报告期内合并财务报表范围变化情况

1) 2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况

公司 2024 年 1-6 月合并报表范围未发生变化。

2) 2023 年合并报表范围变化情况

2023 年一季度，公司子公司新加坡安集完成对 CORDOUAN 的股权收购，实现非同一控制下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。

3) 2022 年合并报表范围变化情况

2022 年 4 月，公司子公司宁波安集股权投资有限公司投资设立了全资子公司新加坡安集，公司自新加坡安集设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

4) 2021 年合并报表范围变化情况

2021 年 1 月，公司投资设立了全资子公司宁波安集股权投资有限公司，公司自宁波安集股权投资有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2021 年 7 月，公司投资设立了全资子公司北京安集微电子科技有限公司，公司自北京安集微电子科技有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2021 年 12 月，公司投资设立了全资子公司上海安集电子材料有限公司，公司自上海安集电子材料有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

三、主要财务指标

（一）主要财务指标

1、基本财务指标

财务指标	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.78	6.96	3.04	3.00
速动比率（倍）	3.28	4.74	2.07	2.30
资产负债率（合并）	21.71%	18.41%	25.69%	28.17%
资产负债率（母公司）	21.95%	18.56%	23.22%	24.00%
财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	5.06	4.78	5.22	5.67
存货周转率（次）	1.45	1.38	1.65	2.01
每股经营活动现金流量（元/股）	1.52	3.39	3.20	1.15
每股净现金流量（元/股）	0.89	2.00	-0.01	-0.10

注：主要财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=期末流动资产总额/期末流动负债总额；
- （2）速动比率=（期末流动资产总额-期末存货账面净额）/期末流动负债总额；
- （3）资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；
- （4）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理；
- （5）存货周转率=营业成本/平均存货净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理；
- （6）每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- （7）每股净现金流量=当期现金流量净额/期末股本总额。

2、净资产收益率与每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）（适用于2023年度和2024年1-6月明细表）及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）（适用于2021年度和2022年度明细表）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项 目	期 间	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-6月	10.38	1.82	1.82
	2023年度	21.47	3.15	3.14
	2022年度	22.20	2.72	2.71
	2021年度	11.11	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-6月	10.42	1.82	1.82
	2023年度	17.16	2.52	2.51
	2022年度	22.12	2.71	2.70
	2021年度	8.10	0.72	0.72

注：报告期内，公司实施了资本公积转增股本，根据相关规定按照调整后的股数重新计算2021年度、2022年度、2023年度的每股收益。

（二）非经常性损益明细表

报告期内，发行人非经常性损益发生额如下表所示：

单位：万元

项目	2024年 1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动资产处置损益	-22.54	-69.09	-5.53	-25.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	688.59	8,791.07	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-	1,190.79	2,647.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以	-741.15	1,752.08	-	-

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
及处置金融资产和交易性金融负债产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-	-927.27	1,783.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27.51	3.20	-4.59	-135.72
小计	-102.61	10,477.26	253.40	4,269.00
所得税影响额	18.00	-2,403.98	-155.09	-871.35
合计	-84.61	8,073.28	98.32	3,397.65

四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

报告期内，公司发生的重要的会计政策变更如下：

1、2021 年会计政策变更

发行人于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则规定及 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会[2018]35 号）（“新租赁准则”）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）及《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9 号）、《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（“解释第 14 号”）。

（1）新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，发行人在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，发行人在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

发行人作为承租人

原租赁准则下，发行人根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给发行人，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，发行人不再区分融资租赁与经营租赁。发行人对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，发行人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

发行人选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，发行人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日发行人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。发行人对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，发行人在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，发行人在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响

在计量租赁负债时，发行人使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。发行人使用的加权平均利率为 4.65%。

2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日租赁负债的调节表：

单位：元

	合并	母公司
2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	41,916,453.09	32,032,733.43
按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值	37,254,794.77	28,816,466.12
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	37,254,794.77	28,816,466.12

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位：元

	合并		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	37,254,794.77	37,254,794.77
非流动资产合计	-	37,254,794.77	37,254,794.77
资产总计	-	37,254,794.77	37,254,794.77
一年内到期的非流动负债	-	(10,019,611.05)	(10,019,611.05)
流动负债合计	-	(10,019,611.05)	(10,019,611.05)
租赁负债	-	(27,235,183.72)	(27,235,183.72)
非流动负债合计	-	(27,235,183.72)	(27,235,183.72)
负债合计	-	(37,254,794.77)	(37,254,794.77)
负债和股东权益总计	-	(37,254,794.77)	(37,254,794.77)

单位：元

	母公司		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	28,816,466.12	28,816,466.12
非流动资产合计	-	28,816,466.12	28,816,466.12
资产总计	-	28,816,466.12	28,816,466.12
一年内到期的非流动负债	-	(5,505,993.20)	(5,505,993.20)
流动负债合计	-	(5,505,993.20)	(5,505,993.20)
租赁负债	-	(23,310,472.92)	(23,310,472.92)
非流动负债合计	-	(23,310,472.92)	(23,310,472.92)

	母公司		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债合计	-	(28,816,466.12)	(28,816,466.12)
负债和股东权益总计	-	(28,816,466.12)	(28,816,466.12)

（2）财会[2020]10 号及财会[2021]9 号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。结合财会 [2021] 9 号的规定，该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额。发行人将执行上述规定的累积影响数调整 2021 年度的年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用上述规定未对发行人的财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“施行日”）起施行。

1) 政府和社会资本合作项目

解释第 14 号及 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008]11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

发行人对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

采用该解释未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

2) 基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的

相关会计处理和披露要求。发行人对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

2、2022 年会计政策变更

发行人于 2022 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（“解释第 15 号”）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（“试运行销售的会计处理”）的规定；解释第 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定；《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会[2022]13 号）；《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（“解释第 16 号”）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定；及解释第 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

采用上述规定未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

3、2023 年会计政策变更

发行人于 2023 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引。

（1）《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会[2020]20 号）（“新保险合同准则”）及相关实施问答

新保险合同准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15 号）。

发行人未发生保险相关交易，采用上述规定未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

（2）《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定

根据该规定，发行人对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，即租赁交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。发行人对该交易初始确认所产生的新增应纳税暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时确认相应的递延所得税负债。

此外，发行人在上述新增应纳税暂时性差异于未来各期间转回时有充足尚未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，因此确认了与递延所得税负债金额相等的递延所得税资产。该新增确认的递延所得税资产和递延所得税负债满足资产负债表净额列报的条件，净额列报后采用上述规定未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

4、2024 年 1-6 月会计政策变更

发行人于 2024 年 1-6 月执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称“解释第 17 号”）中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；《企业会计准则应用指南汇编 2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定。

采用上述规定未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

报告期内，公司未发生会计差错更正事项。

五、财务状况分析

（一）资产状况分析

1、资产构成及其变化分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	159,749.30	53.26	134,230.69	51.56	114,596.60	55.97	99,593.01	59.56
非流动资产	140,212.29	46.74	126,109.42	48.44	90,163.53	44.03	67,629.83	40.44
资产总额	299,961.59	100.00	260,340.11	100.00	204,760.13	100.00	167,222.84	100.00

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，发行人总资产分别为 167,222.84 万元、204,760.13 万元、260,340.11 万元和 299,961.59 万元，总资产整体呈现上升的趋势。其中，发行人流动资产占总资产的比例分别为 59.56%、55.97%、51.56%和 53.26%。

2、流动资产构成及其变化分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	64,572.08	40.42	53,200.55	39.63	32,932.09	28.74	33,263.08	33.40
交易性金融资产	3,447.11	2.16	6,113.14	4.55	16,871.77	14.72	21,937.57	22.03
衍生金融资产	-	-	18.88	0.01	-	-	100.95	0.10
应收票据	44.41	0.03	21.90	0.02	193.05	0.17	135.59	0.14
应收账款	34,902.52	21.85	28,178.86	20.99	23,564.17	20.56	17,673.03	17.75
预付款项	4,747.70	2.97	2,755.16	2.05	2,905.44	2.54	1,092.00	1.10
其他应收款	236.15	0.15	130.83	0.10	121.11	0.11	88.40	0.09
存货	50,190.18	31.42	42,721.07	31.83	36,589.90	31.93	23,042.17	23.14
其他流动资产	1,609.14	1.01	1,090.30	0.81	1,419.07	1.24	2,260.21	2.27
合计	159,749.30	100.00	134,230.69	100.00	114,596.60	100.00	99,593.01	100.00

发行人流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项、

存货和其他流动资产等构成。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
银行存款	64,179.88	52,756.38	32,902.00	33,010.76
其他货币资金	392.19	444.16	30.09	252.32
合计	64,572.08	53,200.55	32,932.09	33,263.08
其中：存放在境外的款项总额	412.54	567.61	154.50	132.01

公司货币资金主要由银行存款构成。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司货币资金大幅上升，主要原因是公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位及经营积累所致。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产的构成如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,447.11	6,113.14	16,871.77	21,937.57
其中：理财产品	-	2,000.64	8,008.03	10,527.77
权益工具投资	3,447.11	4,112.50	8,863.74	11,409.81

公司的交易性金融资产包括：1）公司为提升资金使用效率，使用募集资金暂时性进行现金管理购买的理财产品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交易性金融资产的权益工具投资系公司于 2020 年出资人民币 1 亿元与其他投资方共同设立青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的战略配售所持有的青岛聚源合伙份额；2023 年末及 2024 年 6 月末，公司计入交易性金融资产的权益工具投资系公司出资人民币 5,000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市战略配售而持有的华虹半导体有限公司的股权。

报告期内，公司交易性金融资产金额逐年下降，主要是由于：1）公司进行暂时性现金管理所购买的理财产品金额下降；2）公司持有的青岛聚源合伙份额及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司逐步处置了所持有的青岛

聚源合伙份额。

（3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收账款账面余额	36,740.03	29,662.61	24,804.24	18,608.39
坏账准备	1,837.50	1,483.74	1,240.07	935.36
应收账款账面价值	34,902.52	28,178.86	23,564.17	17,673.03

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 17,673.03 万元、23,564.17 万元、28,178.86 万元和 34,902.52 万元。报告期内，公司应收账款账面余额总体呈增长趋势，主要原因是公司生产经营规模扩大，营业收入增长较快所致。公司应收账款期后回款情况良好。

1) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提分类如下：

类别	2024.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	36,740.03	100.00%	1,837.50	5.00%	34,902.52
合计	36,740.03	100.00%	1,837.50	5.00%	34,902.52
类别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	29,662.61	100.00%	1,483.74	5.00%	28,178.86
合计	29,662.61	100.00%	1,483.74	5.00%	28,178.86
类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,804.24	100.00%	1,240.07	5.00%	23,564.17
合计	24,804.24	100.00%	1,240.07	5.00%	23,564.17

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5.20	0.03%	5.20	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,603.19	99.97%	930.16	5.00%	17,673.03
合计	18,608.39	100.00%	935.36	5.03%	17,673.03

2) 坏账准备计提分析

公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。报告期各期末，预期信用损失的具体分析如下：

单位：万元

2024.6.30			
账龄	预期信用损失率	应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5%	36,737.64	1,837.26
1 至 2 年（含 2 年）	10%	2.39	0.24
合计		36,740.03	1,837.50
2023.12.31			
账龄	预期信用损失率	应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5%	29,651.93	1,482.68
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10.68	1.07
合计		29,662.61	1,483.74
2022.12.31			
账龄	预期信用损失率	应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5%	24,804.24	1,240.07
合计		24,804.24	1,240.07
2021.12.31			
账龄	预期信用损失率	应收账款	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5%	18,603.19	930.16
3 年以上	100%	5.20	5.20

合计		18,608.39	935.36
----	--	-----------	--------

(4) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元，%

账龄	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	4,708.93	99.18	2,731.95	99.16	2,474.76	85.18	1,085.39	99.39
1 至 2 年（含 2 年）	37.27	0.79	19.88	0.72	427.96	14.73	6.28	0.57
2 至 3 年（含 3 年）	1.50	0.03	2.09	0.08	2.39	0.08	0.33	0.03
3 年以上	-	-	1.23	0.04	0.33	0.01	-	-
合计	4,747.70	100.00	2,755.16	100.00	2,905.44	100.00	1,092.00	100.00

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司预付账款分别为 1,092.00 万元、2,905.44 万元、2,755.16 万元和 4,747.70 万元，主要系预付原材料采购货款。2022 年末和 2024 年 6 月末，公司预付款项上升幅度较大，主要是由于原材料备货增长所致。报告期各期末，预付款项总体规模较低且绝大部分账龄在 1 年以内。

(5) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收利息	-	-	-	-	-	-	1.45	1.64
其他	236.15	100.00	130.83	100.00	121.11	100.00	86.94	98.35
合计	236.15	100.00	130.83	100.00	121.11	100.00	88.40	100.00

公司其他应收款由应收利息和其他构成，应收利息来自定期存款，除应收利息外的其他应收款主要为退税款、员工往来款、保证金、代垫款等。

(6) 存货

1) 存货总体情况

报告期各期末，发行人存货的构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30			
	账面原值	占比	跌价准备	账面价值
原材料	39,360.11	77.53%	509.90	38,850.21
库存商品	7,905.37	15.57%	69.93	7,835.44
合同履约成本	107.63	0.21%	-	107.63
发出商品	3,396.90	6.69%	-	3,396.90
合计	50,770.01	100.00%	579.83	50,190.18
项目	2023.12.31			
	账面原值	占比	跌价准备	账面价值
原材料	32,796.11	75.56%	598.10	32,198.01
库存商品	7,317.08	16.86%	85.19	7,231.89
合同履约成本	114.10	0.26%	-	114.10
发出商品	3,177.07	7.32%	-	3,177.07
合计	43,404.36	100.00%	683.29	42,721.07
项目	2022.12.31			
	账面原值	占比	跌价准备	账面价值
原材料	25,801.11	69.68%	191.17	25,609.95
库存商品	6,211.23	16.77%	248.70	5,962.54
合同履约成本	278.41	0.75%	-	278.41
发出商品	4,739.01	12.80%	-	4,739.01
合计	37,029.77	100.00%	439.86	36,589.90
项目	2021.12.31			
	账面原值	占比	跌价准备	账面价值
原材料	15,424.21	66.61%	77.71	15,346.50
库存商品	3,937.35	17.00%	37.49	3,899.87
合同履约成本	169.00	0.73%	-	169.00
发出商品	3,626.81	15.66%	-	3,626.81
合计	23,157.37	100.00%	115.20	23,042.17

2) 存货余额变动分析

①原材料

报告期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生产用原材料。报告期各期末，公司存货中原材料余额持续上升，主要是由于随着

公司生产经营规模不断扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来源以进口为主，为应对全球公共卫生事件、国际贸易政策等外部环境的不确定性带来的公司进口原材料交付周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较大。

②库存商品、发出商品

公司的产成品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该模式下当公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库时，将相关存货从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司产成品账面余额为 7,564.16 万元、10,950.24 万元、10,494.15 万元和 11,302.27 万元，呈现上升的趋势，主要是由于客户通常会要求公司备 2 个月左右的存货以保证公司产品的持续供应，随着公司客户数量和需求的上升，公司产成品的账面余额呈现上升趋势；另一方面，部分客户会要求公司对推出的新产品准备相对更高的安全库存量以应对新产品逐步放量过程中的风险，确保产品持续可靠供应。

③合同履约成本

公司将不构成单项履约义务的运输活动相关成本作为合同履约成本。报告期各期末，公司存货中合同履约成本系与发出商品相关的运输费用。

3) 存货跌价准备

报告期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货的估计售价、是否过期以及客户对存货的需求等因素确定存货可变现净值。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司计提的存货跌价准备金额分别为 115.20 万元、439.86 万元、683.29 万元和 579.83 万元。

（7）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待抵扣进项税额	1,127.87	70.09	985.79	90.41	1,418.76	99.98	2,259.49	99.97
预缴所得税	457.91	28.46	103.19	9.46	-	-	-	-

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他	23.36	1.45	1.33	0.12	0.31	0.02	0.72	0.03
合计	1,609.14	100.00	1,090.30	100.00	1,419.07	100.00	2,260.21	100.00

报告期各期末，公司其他流动资产主要为购买设备和原材料产生的待抵扣进项税额、预缴所得税。

3、非流动资产构成及其变化分析

报告期各期末，发行人非流动资产结构如下表所示：

单位：万元、%

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	10,933.88	7.80	11,201.45	8.88	7,424.43	8.23	3,970.56	5.87
其他权益工具投资	6,200.66	4.42	6,280.00	4.98	3,683.17	4.08	900.00	1.33
其他非流动金融资产	13,871.66	9.89	13,930.00	11.05	9,786.17	10.85	5,181.52	7.66
固定资产	45,599.18	32.52	30,869.89	24.48	24,161.66	26.80	25,501.35	37.71
在建工程	13,595.04	9.70	17,870.99	14.17	19,245.55	21.35	11,144.02	16.48
使用权资产	8,711.51	6.21	9,617.64	7.63	10,936.33	12.13	13,704.02	20.26
无形资产	7,881.63	5.62	8,022.67	6.36	3,375.64	3.74	1,225.03	1.81
商誉	738.95	0.53	738.95	0.59	-	-	-	-
长期待摊费用	14,267.96	10.18	13,492.24	10.70	1,667.67	1.85	1,103.04	1.63
递延所得税资产	4,878.73	3.48	4,434.57	3.52	4,523.28	5.02	4,171.54	6.17
其他非流动资产	13,533.08	9.65	9,651.02	7.65	5,359.62	5.94	728.75	1.08
合计	140,212.29	100.00	126,109.42	100.00	90,163.53	100.00	67,629.83	100.00

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 67,629.83 万元、90,163.53 万元、126,109.42 万元和 140,212.29 万元，呈逐步增长的趋势。公司非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产等构成。

（1）长期股权投资

截至报告期末，公司长期股权投资系对联营企业安特纳米、钨熠电子、硅研电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本募集说明书摘要“第四节 财务会计信息与管理层分析”之“五、财务状况分析”之“（五）财务性投资情况”。

(2) 其他权益工具投资

截至报告期末，公司其他权益工具投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本募集说明书摘要“第四节 财务会计信息与管理层分析”之“五、财务状况分析”之“（五）财务性投资情况”。

(3) 其他非流动金融资产

截至报告期末，公司其他非流动金融资产系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本募集说明书摘要“第四节 财务会计信息与管理层分析”之“五、财务状况分析”之“（五）财务性投资情况”。

(4) 固定资产

报告期内，公司固定资产主要为房屋及建筑物和研发及生产设备。报告期各期末，公司固定资产的原值及净值构成如下：

单位：万元

项目	2024.6.30			
	原值	累计折旧	账面价值	账面价值占比
房屋及建筑物	10,339.70	999.88	9,339.82	20.48%
研发及生产设备	53,354.04	17,996.77	35,357.27	77.54%
办公设备及其他设备	68.10	46.83	21.27	0.05%
运输工具	122.12	86.08	36.04	0.08%
电子设备	1,388.80	544.02	844.78	1.85%
合计	65,272.75	19,673.58	45,599.18	100.00%
项目	2023.12.31			
	原值	累计折旧	账面价值	账面价值占比
房屋及建筑物	5,343.49	821.94	4,521.56	14.65%
研发及生产设备	40,475.45	15,068.43	25,407.02	82.30%
办公设备及其他设备	46.98	44.87	2.11	0.01%
运输工具	122.12	78.51	43.61	0.14%
电子设备	1,301.39	405.80	895.59	2.90%
合计	47,289.43	16,419.54	30,869.89	100.00%
项目	2022.12.31			

	原值	累计折旧	账面价值	账面价值占比
房屋及建筑物	5,343.49	522.63	4,820.86	19.95%
研发及生产设备	29,833.53	10,836.77	18,996.76	78.62%
办公设备及其他设备	53.31	47.68	5.63	0.02%
运输工具	122.98	64.10	58.88	0.24%
电子设备	501.45	221.92	279.52	1.16%
合计	35,854.76	11,693.10	24,161.66	100.00%
项目	2021.12.31			
	原值	累计折旧	账面价值	账面价值占比
房屋及建筑物	5,182.80	397.25	4,785.55	18.77%
研发及生产设备	27,764.55	7,386.18	20,378.37	79.91%
办公设备及其他设备	103.55	95.68	7.86	0.03%
运输工具	122.98	46.84	76.14	0.30%
电子设备	408.41	154.99	253.43	0.99%
合计	33,582.30	8,080.94	25,501.35	100.00%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 25,501.35 万元、24,161.66 万元、30,869.89 万元和 45,599.18 万元，整体呈上升趋势。2024 年 6 月末，公司固定资产金额增长较多，主要系部分首次公开发行股票募集资金投资项目于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。

报告期内，公司固定资产运行良好，能够按照预定用途发挥经济效益，不存在需要计提减值准备的情形。

（5）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11,144.02 万元、19,245.55 万元、17,870.99 万元和 13,595.04 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公司首次公开发行股票及 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，募投项目开始建设，使得在建工程规模增长。2024 年 6 月末，公司在建工程金额有所下降，主要系部分首次公开发行股票募集资金投资项目于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。

（6）使用权资产

根据新租赁准则，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产。截至 2024 年 6 月末，公司使用权资产余额为 8,711.51 万元，主要系公司租赁的厂房、办公楼及仓库。

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
专利权、技术许可、客户关系及其他合同权利	2,125.44	2,236.38	2,146.67	90.25
土地使用权	4,542.83	4,589.84	935.15	955.54
软件	1,213.35	1,196.45	293.82	179.24
合计	7,881.63	8,022.67	3,375.64	1,225.03

报告期内，公司在自有技术持续数年开发的基础上，通过国际技术合作的形式，完善和强化了电化学沉积领域的技术平台。2022 年末，公司无形资产中“专利权、技术许可及客户关系”金额增加主要系公司向合作方支付的一次性许可对价。2023 年末，公司无形资产大幅增加主要系子公司安集电子材料购买土地使用权及公司各类信息系统软件上线所致。报告期内，公司无形资产使用状况良好，不存在需要计提减值准备的情形。

（8）商誉

2024 年 6 月末，公司商誉的账面价值为 738.95 万元。2023 年一季度，公司收购 CORDOUAN 构成非同一控制下企业合并，公司将合并成本与可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉。根据《企业会计准则》的要求，公司于每年年末对商誉进行减值测试，截至报告期末商誉不存在减值情况。

（9）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 1,103.04 万元、1,667.67 万元、13,492.24 万元和 14,267.96 万元，主要为房屋装修费。2023 年末，长期待摊费用大幅增长，主要因公司位于上海金桥的研发中心和生产基地装修改造验收所致。

（10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 728.75 万元、5,359.62 万元、9,651.02 万元和 13,533.08 万元，主要为预付的设备工程款、长期保证金、待抵扣增值税等。2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产金额较高，主要系首次公开发行股票及以简易程序向特定对象发行股票募投项目建设加快，资金投入较多，期末形成了较高的预付设备工程款。

（二）负债状况分析

1、负债结构分析

报告期各期末，发行人流动负债和非流动负债的构成如下表：

单位：万元、%

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	33,448.91	51.35	19,296.46	40.25	37,684.30	71.64	33,219.70	70.52
非流动负债	31,684.41	48.65	28,639.14	59.75	14,920.83	28.36	13,887.05	29.48
负债总额	65,133.32	100.00	47,935.60	100.00	52,605.13	100.00	47,106.75	100.00

报告期内，随着业务规模的扩大，发行人的流动负债和非流动负债的规模呈上升趋势。从负债构成上分析，报告期各期末发行人流动负债占比分别为 70.52%、71.64%、40.25%及 51.35%，非流动负债占比分别为 29.48%、28.36%、59.75%及 48.65%。2023 年末流动负债占比有所下降，主要系部分政府补助项目验收确认，相关款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。

2、流动负债构成分析

报告期各期末，发行人各类流动负债金额及占流动负债的比例情况如下：

单位：万元、%

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	986.81	2.95	986.81	5.11	3,002.67	7.97	1,588.60	4.78
应付账款	17,481.75	52.26	8,050.47	41.72	8,572.11	22.75	8,079.29	24.32
合同负债	1,691.89	5.06	706.73	3.66	27.32	0.07	24.88	0.07
应付职工薪酬	2,585.82	7.73	2,819.78	14.61	2,640.24	7.01	1,395.11	4.20
应交税费	1,165.59	3.48	626.37	3.25	2,271.00	6.03	2,270.12	6.83
其他应付款	6,147.57	18.38	2,939.55	15.23	18,764.57	49.79	17,163.10	51.67

类别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动负债	3,389.47	10.13	3,166.73	16.41	2,406.39	6.39	2,698.60	8.12
合计	33,448.91	100.00	19,296.46	100.00	37,684.30	100.00	33,219.70	100.00

报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款等构成。

（1）短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
信用借款	986.81	986.81	3,002.67	1,588.60
合计	986.81	986.81	3,002.67	1,588.60

报告期内，公司的短期借款为信用借款。截至 2024 年 6 月末，短期借款系公司向招商银行借入的流动资金贷款。

（2）应付账款

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，发行人应付账款期末余额分别为 8,079.29 万元、8,572.11 万元、8,050.47 万元和 17,481.75 万元，主要为应付货款和应付项目工程款。

（3）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,395.11 万元、2,640.24 万元、2,819.78 万元和 2,585.82 万元。公司应付职工薪酬主要由短期薪酬构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准以及激励制度相关。

（4）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
尚未验收的政府补助	2,986.25	2,369.25	18,155.75	16,818.00
员工股权激励暂收款	2,756.88	-	-	-
预提费用	395.91	361.27	517.01	278.67

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应付利息	-	-	-	0.27
其他	8.54	209.04	91.81	66.16
合计	6,147.57	2,939.55	18,764.57	17,163.10

报告期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其他应付款大幅下降，主要是由于部分政府补助项目验收确认，相关款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。

3、非流动负债构成分析

报告期各期末，发行人各类非流动负债金额及占非流动负债的比例情况如下：

单位：万元、%

类 别	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	14,782.00	46.65	9,459.06	33.03	2,990.00	20.04	-	-
租赁负债	7,329.26	23.13	8,285.16	28.93	9,896.31	66.33	11,689.52	84.18
递延收益	9,114.96	28.77	10,202.81	35.63	1,850.88	12.40	2,197.53	15.82
递延所得税负债	458.18	1.45	692.11	2.42	183.65	1.23	-	-
合 计	31,684.41	100.00	28,639.14	100.00	14,920.83	100.00	13,887.05	100.00

报告期内，公司非流动负债主要由长期借款、租赁负债和递延收益构成。

（1）长期借款

2024 年 6 月末，公司长期借款系向中国银行、中国建设银行、招商银行借入的流动资金贷款、向中国光大银行借入的并购贷款及向中国银行借入的固定资产借款。

（2）租赁负债

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司租赁负债分别为 11,689.52 万元、9,896.31 万元、8,285.16 万元和 7,329.26 万元，占非流动负债的比例分别为 84.18%、66.33%、28.93%和 23.13%。

（3）递延收益

报告期各期末，发行人递延收益余额分别为 2,197.53 万元、1,850.88 万元、10,202.81 万元及 9,114.96 万元，主要为与资产相关的政府补助。2023 年末，公

司递延收益余额增幅较大，主要系部分政府补助项目验收确认所致。

（三）偿债能力分析

报告期各期末，公司与偿债能力有关的主要财务指标如下：

财务指标	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.78	6.96	3.04	3.00
速动比率（倍）	3.28	4.74	2.07	2.30
资产负债率（合并）	21.71%	18.41%	25.69%	28.17%

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司流动比率分别为 3.00、3.04、6.96 和 4.78，速动比率分别为 2.30、2.07、4.74 和 3.28，资产流动性较好。

2023 年末，公司流动比率和速动比率有所上升，主要是由于公司于 2023 年 3 月完成向特定对象发行股票，募集资金到位导致货币资金大幅上升，同时 2023 年上半年政府补助项目验收确认使得其他应付款下降所致。

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 28.17%、25.69%、18.41%和 21.71%。2022 年末公司资产负债率有所下降，主要系公司盈利情况良好，资产及未分配利润增加较多所致。2023 年末公司资产负债率较 2022 年末进一步下降，主要由于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金于 2023 年 3 月末到位导致资产总额上升所致。

报告期内，公司与境内外可比公司的偿债能力指标比较情况如下：

公司简称	2024 年 6 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
资产负债率				
Entegris	57.99%	61.32%	68.26%	46.31%
Fujifilm	-	33.66%	32.57%	36.16%
Resonac	69.48%	71.52%	72.55%	61.80%
Merck	42.62%	44.83%	46.41%	52.79%
DuPont	34.99%	35.87%	34.67%	40.82%
上海新阳	25.77%	24.35%	26.08%	24.92%
可比公司平均值	46.17%	45.26%	46.76%	43.80%
发行人	21.71%	18.41%	25.69%	28.17%

公司简称	2024 年 6 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
流动比率（倍）				
Entegris	3.58	3.85	3.06	3.47
Fujifilm	-	1.35	1.83	1.76
Resonac	1.61	1.63	1.72	1.63
Merck	1.31	1.42	1.28	1.05
DuPont	2.21	2.43	3.02	2.90
上海新阳	2.50	2.64	2.33	2.45
可比公司平均值	2.24	2.22	2.21	2.21
发行人	4.78	6.96	3.04	3.00
速动比率（倍）				
Entegris	2.14	2.67	2.00	2.21
Fujifilm	-	0.88	1.19	1.25
Resonac	1.15	1.14	1.17	1.22
Merck	0.84	0.89	0.80	0.68
DuPont	1.44	1.73	2.40	2.48
上海新阳	2.14	2.28	2.00	2.16
可比公司平均值	1.54	1.60	1.59	1.67
发行人	3.28	4.74	2.07	2.30

注 1：以上数据来源于可比公司定期报告；

注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年以此类推；

注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为增加可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据对应其截至 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年以此类推；

注 4：Dupont、上海新阳因会计政策变更对 2021 年年度数据进行追溯调整，Resonac 因会计政策变更对 2022 年年度数据进行追溯调整，本报告选取调整后最新可获取的数据进行比较；

注 5：下文同。

报告期内，公司的资产负债率总体低于境内外可比公司平均值，流动比率和速动比率总体高于境内外可比公司平均值，主要原因为公司持续控制应收账款增长，销售回款良好，同时公司及时支付供应商款项等债务，整体偿债能力较强。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率情况如下：

财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	5.06	4.78	5.22	5.67
存货周转率（次）	1.45	1.38	1.65	2.01

报告期内，公司与境内外可比公司的资产周转能力指标比较情况如下：

公司简称	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）				
Entegris	6.93	7.10	7.43	7.52
Fujifilm	-	4.45	4.64	4.19
Resonac	4.94	4.88	4.78	4.69
Merck	5.07	5.17	5.73	5.73
DuPont	5.21	4.94	5.57	5.49
上海新阳	2.38	2.45	3.19	3.33
可比公司平均值	4.91	4.83	5.22	5.16
发行人	5.06	4.78	5.22	5.67
存货周转率（次）				
Entegris	2.76	2.85	2.93	3.10
Fujifilm	-	3.18	3.21	3.24
Resonac	4.47	4.38	4.80	5.49
Merck	1.81	1.86	2.00	2.04
DuPont	3.63	3.50	3.81	3.56
上海新阳	2.84	2.74	2.87	3.20
可比公司平均值	3.10	3.09	3.27	3.44
发行人	1.45	1.38	1.65	2.01

报告期内，公司应收账款周转率总体处于境内外可比公司平均值区间内。

报告期内，公司存货周转率总体低于境内外可比公司平均值，主要是由于公司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，通常情况下，公司在考虑产成品安全库存量时，一方面客户通常会要求公司备 2 个月左右的存货以保证公司产品的持续供应；另一方面公司为保证产品质量的稳定，通常在连续生产周期内的备货量会高于客户要求的备货量。因此，公司库存商品期末存货余额较大。对于原材料，公司原材料进口占比较高，由于从境外采购原材料通常需要 2 至 4 个月的时间才能到货，通常公司需要预备 3 至 4 个月的原材料以满足生产需求。从供应安全和及时性等角度考虑，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较大。因此，公司存货周转率整体低于可比公司平均值。

（五）财务性投资情况

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》有关规定：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

截至2024年6月末，发行人资产负债表中可能与财务性投资相关的会计科目及是否属于财务性投资的情况如下：

单位：万元

序号	会计科目	截至2024.6.30账面价值	是否属于财务性投资
1	其他应收款	236.15	否
2	其他流动资产	1,609.14	否
3	长期股权投资	10,933.88	否
4	其他权益工具投资	6,200.66	否
5	其他非流动金融资产	13,871.66	具体分析参见下文“5、其他非流动金融资产”
6	其他非流动资产	13,533.08	否
7	交易性金融资产	3,447.11	否
8	衍生金融资产	-	-

1、其他应收款

截至2024年6月末，公司其他应收款账面价值为236.15万元，主要为应收退税款、员工往来款、押金及保证金等，不涉及财务性投资。

2、其他流动资产

截至2024年6月末，公司其他流动资产金额为1,609.14万元，主要为待抵

扣进项税、预缴所得税等，不涉及财务性投资。

3、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，公司长期股权投资为对联营企业安特纳米、钜熠电子、硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钜熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对公司获取技术、原料或渠道的具体情况如下：

单位：万元

被投资企业	截至2024.6.30账面价值	主营业务	对公司获取技术、原料或渠道的具体内容
安特纳米	3,090.97	硅溶胶的研发、生产和销售。	硅溶胶系公司主要产品化学机械抛光液的关键原材料之一，公司参与投资设立安特纳米，主要目的是提升硅溶胶的自主可控生产供应能力，有助于公司获取硅溶胶原料；根据《山东安特纳米材料有限公司股东协议》，安特纳米生产的硅溶胶产品应当首先满足公司的需求。2023年度、2024年1-6月，公司分别向安特纳米采购硅溶胶99.30万元、268.57万元。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，宁波安集投资有权提名1名董事。因此，公司投资安特纳米，有助于未来获取硅溶胶原材料，提升公司产品的自主可控生产供应能力。
钜熠电子	3,732.59	主要从事 OLED 材料和器件研发、试产、工艺开发及销售。	钜熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，其核心技术与公司现有产品研发具有一定协同性，可为公司提供一定的技术支持，报告期内钜熠电子为公司提供了少量与公司主要产品相关的高分子材料合成服务。此外，公司副总经理、董事会秘书杨逊担任钜熠电子董事。因此，公司投资钜熠电子，有助于提升公司自身材料合成技术及未来获取高分子材料。
SEPPURE	2,155.70	专注于特种纳滤纤维膜材料研发与销售。	纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器产品中的关键耗材，广泛应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半导体材料生产过程中的污染控制、超高纯化学品的纯化、混合物的分离与回收等方面起着关键作用。过滤为公司产品生产工艺的关键流程之一，过滤器为公司产品生产过程中的关键耗材。在公司产品开发环节，需要持续定制高端过滤器产品（关键在于膜的特殊选型），以面向更高工艺节点的颗粒物控制并实现抛光液性能的提升；在公司产品生产制造环节，纯水系统、循环回收系统等工艺控制方面需要使用大量稳定可靠的过滤器产品，以实现原料和成品的质量控制；在公司下游客户供液环节，需要搭配过滤器产品以去除产品运输储存等过程中的颗粒团聚。根据相关投资协议约定，本次投资后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董事、副总经理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜领域相关技术，同时布局有竞争力并有广阔前景的分子级纳滤膜材料。
硅研电子	1,954.62	集成电路 CMP 研磨颗粒的研发、生产和销售。	研磨颗粒系公司主要产品化学机械抛光液的关键原材料之一，公司投资硅研电子主要目的是提升研磨颗粒的自主可控生产供应能力，有助于公司获取原料；根据《河北硅研电子材料有限公司股东协议》，未经公司事先书面同意，硅研电子不得协助公司竞争对手开展半导体芯片制造用抛光及半导体表面精细研磨处理业务。此外，硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，提升公司产品的自主可控生产供应能力。

公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料领域的业务布局，完善并延伸产业链，助力进一步提升关键材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符

合公司主营业务及战略发展方向，因此不界定为财务性投资。

4、其他权益工具投资

截至 2024 年 6 月末，公司其他权益工具投资为对湖北三维创新中心、芯链融创、中科同芯、天德合享的投资，相关被投资企业对公司获取技术、原料或渠道的具体情况如下：

单位：万元

被投资企业	截至 2024.6.30 账面价值	主营业务	对公司获取技术、原料或渠道的具体内容
湖北三维创新中心	590.66	湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联合国内外半导体领域知名企业与科研院所发起组建，致力于突破“超越摩尔”三维集成制造关键共性技术，向行业提供半导体三维集成技术服务与支持，推动三维集成制造领域产、学、研、用、资创新资源聚合与产业链协同创新，已建成共性技术研发、产业综合服务、成果转化与企业育成三大平台。该中心是湖北省落实国家“制造强国、网络强国”建设重大部署，加强半导体制造创新平台建设，提升半导体产业基础能力和产业链水平，应对国际竞争的重大举措，也是全国半导体三维集成制造领域首个省级创新中心。湖北三维创新中心采用“公司+联盟”的方式运营。	公司投资湖北三维创新中心为公司开展三维集成关键技术创新提供了平台支持，并为相关产品的工艺验证提供了渠道，有助于公司推进三维集成领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发并促进相关产品在三维集成领域的应用，巩固了主要客户资源渠道，与公司主营业务具有较强的相关性和协同性，符合公司主营业务及战略发展方向。报告期内，公司三维集成用系列抛光液在与多个客户进行合作开发和测试验证，进展顺利。此外，公司为中国半导体三维集成制造产业联盟理事单位，报告期内定期向湖北三维创新中心缴纳联盟会费。
芯链融创	500.00	芯链融创由中关村芯链集成电路制造产业联盟牵头，联合包括公司在内的25家集成电路产业链企业出资设立，旨在打造集成电路设备、零部件和材料产业链融合平台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司（以下简称“北方创新中心”），拟借助集成电路产业链资源优势推进国产化设备、零部件和材料的验证进程。	公司投资芯链融创并间接投资北方创新中心，有助于推进前沿技术及产品的研发验证，并巩固主要客户资源渠道，与公司主营业务具有较强的相关性和协同性，符合公司主营业务及战略发展方向。一方面，北方创新中心旨在与创新单位合作，联合开发有市场潜力的新型芯片产品，开展新器件、新材料、新工艺、新架构的制造技术研发，探索集成电路的前沿技术路径，重点建设创新技术产业化开发的战略能力。2022年度、2023年度、2024年1-6月，公司向北方创新中心销售化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品金额合计35.25万元、104.24万元、227.55万元。另一方面，北方创新中心系公司客户的联营企业，公司通过投资芯链融创间接投资于北方创新中心，能够帮助公司巩固主要客户资源，并助力未来产品的客户验证和产能消化工作，提升新产品在客户的验证效率，加速产品验证及落地，提高为下游客户服务的质量和效率。
中科同芯	5,010.00	中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广州）有限责任公司（以下简称“锐立平芯”）之公司股权，锐立平芯是采用FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工厂。	锐立平芯作为集成电路制造厂商，聚焦于打造FDSOI特色工艺量产平台，实现FDSOI技术成熟并产业化，是公司FDSOI工艺应用领域重要的潜在

被投资企业	截至 2024.6.30 账面价值	主营业务	对公司获取技术、原料或渠道的具体内容
			客户。公司作为国内关键半导体材料代表性供应商之一，通过投资平台中科同芯间接投资锐立平芯，将从业务及资本双层面与锐立平芯形成紧密联系，建立全方面长期战略合作关系，有助于拓宽客户渠道。
天德合享	100.00	天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），盛芯通泰旨在打造面向集成电路行业的智慧供应链平台，为集成电路企业提供公共供应链服务。	公司作为集成电路关键材料供应商，通过天德合享间接投资盛芯通泰有助于获取下游集成电路制造及封装厂商需求数据及相关数字供应链服务，并加强与集成电路产业链企业之间的交流合作。除公司外，天德合享其他有限合伙人还包括江苏南大光电材料股份有限公司、杭州科百特过滤器材有限公司等半导体材料产业链上企业。

公司上述投资均属于在集成电路领域或产业链上下游的产业投资，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，因此不界定为财务性投资。

5、其他非流动金融资产

截至 2024 年 6 月末，公司其他非流动金融资产系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：

单位：万元

被投资企业	截至 2024.6.30账 面价值	约定的投资范围
嘉兴红晔	2,445.66	“6.1 投资策略及投资范围 合伙企业将主要针对中国境内和境外半导体产业的私募股权项目（包括但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开发行或交易的股票、可转债、市场化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督管理委员会认可的其他资产）进行股权或准股权投资。”
合肥溯慈	5,701.67	专项用于认购“石溪产恒二期”有限合伙人份额，石溪产恒二期的投资领域（投资方向）为“半导体集成电路及显示、新一代信息技术、智能制造和新材料等。重点关注：（1）半导体集成电路及显示产业链，聚焦新材料、设备、部件、工艺并包括设计、封测、维护、技术服务以及信息产品、制造、应用环节的关键技术和产品等；（2）宽禁带半导体材料、新型显示材料等产业关键材料；（3）新一代移动通信核心芯片、器件、系统及设备；（4）人工智能芯片支撑技术及应用。”
徐州盛芯	2,095.49	“第七条 企业宗旨 产融结合，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。” “第八条 投资准则 1. 投资方向：对泛半导体材料及相关产业进行投资。”
聚源振芯	2,128.84	“3.1 投资范围 3.1.1 在适用法律法规允许的范围内，本合伙企业将围绕在集成电路、半导体及其上下游产业（包括但不限于由5G及AI的发展所带动的移动通信、汽车电子、消费电子、安防监控、物联网、云计算、智能制造等相关细分领域）相关领域的业务成熟、已形成一定规模和能产生稳定现金流的企业，专注于并购整合投资（“主要方向”），从而实现合伙企业资产的资本增值，

被投资企业	截至 2024.6.30账 面价值	约定的投资范围
		包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的整合重组、为并购项目提供融资支持等。”
长存产业基金	1,500.00	长存产业基金主要以服务存储行业为首要目标，聚焦投资存储产业链上下游的优质股权投资项目。

公司上述产业基金投资为围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向。考虑公司对嘉兴红晔、合肥溯慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有实际管理权或控制权等原因，基于谨慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。截至 2024 年 6 月末，公司该等财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

公司投资长存产业基金有助于巩固和拓展公司在存储芯片领域的客户资源，属于围绕产业链上下游以获取渠道为目的的产业投资；长存产业基金的投资方向、普通合伙人的权限划分、投资决策机制及投资决策委员会构成能够确保其始终围绕存储产业链上下游进行项目投资，进而与公司主营业务及战略发展方向密切相关；公司投资长存产业基金旨在服务国家战略和公司发展战略，不以获取长存产业基金或其投资项目的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

6、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产金额为 13,533.08 万元，主要为预付的设备工程款、长期保证金等，不涉及财务性投资。

7、交易性金融资产

截至 2024 年 6 月末，公司交易性金融资产金额为 3,447.11 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	截至 2024.6.30 账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,447.11
其中：理财产品	-
权益工具投资	3,447.11

截至 2024 年 6 月末，公司交易性金融资产中的权益工具投资系公司作为华虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的关键半导体材料供应商之一参与华虹

公司首发上市战略配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司作为与华虹公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有参与其战略配售的资格。同时，公司与华虹公司签署了《战略合作备忘录》，明确双方将在增加未来业务订单、供应链自主可持续发展、资本运营、技术研发、深化改革、产业链延伸等方面持续深化合作。华虹公司是公司的重要客户，公司作为华虹公司的关键半导体材料供应商之一参与华虹公司首发上市战略配售，系基于双方在各自行业中所处地位及双方长远发展战略上的考虑，能促进公司进一步从业务及资本双层面与华虹公司形成紧密战略合作关系，属于围绕产业链上下游以获取渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（8）衍生金融资产

截至 2024 年 6 月末，公司不存在衍生金融资产。

综上，截至 2024 年 6 月末，公司财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

六、经营成果分析

公司最近三年一期的利润表主要指标如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	79,727.35	123,787.11	107,678.73	68,666.06
营业成本	33,710.07	54,695.69	49,306.10	33,589.38
营业利润	25,059.81	44,039.04	33,924.47	13,342.48
利润总额	25,009.76	44,042.25	33,919.88	13,206.77
净利润	23,399.58	40,273.38	30,143.70	12,508.41
归属于母公司股东的净利润	23,399.58	40,273.38	30,143.70	12,508.41

（一）营业收入

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，自成立以来一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键

半导体材料的空白。报告期内，公司进一步拓展产品及技术平台，成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列平台。

1、营业收入概况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

项 目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	79,710.61	99.98	123,745.28	99.97	107,628.94	99.95	68,636.98	99.96
其他业务收入	16.74	0.02	41.83	0.03	49.80	0.05	29.09	0.04
营业收入合计	79,727.35	100.00	123,787.11	100.00	107,678.73	100.00	68,666.06	100.00

报告期内，公司营业收入呈稳定增长态势，主要来自于主营业务收入，主营业务突出。公司成功打破了国外厂商的垄断并已成为高端半导体材料领域国内领先、国际先进的供应商，报告期内随着半导体产业的发展及下游客户用量的上升，营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行市场开拓，加强客户拓展，在已有客户已有产品的基础上不断加大支持力度、扩大份额，并加快产品的测试论证及销售放量；另一方面，公司前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好，使公司产品在客户端的用量明显上升。公司营业收入保持持续增长符合下游集成电路产业发展态势。

2、按产品构成分析

报告期内，公司按产品进行分类的营业收入情况如下：

单位：万元、%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化学机械抛光液	67,284.15	84.39	107,464.09	86.81	95,121.62	88.34	59,403.47	86.51
功能性湿电子化学品	11,783.35	14.78	15,458.79	12.49	12,429.04	11.54	9,087.08	13.23
其他	643.11	0.81	822.40	0.66	78.28	0.07	146.42	0.21
主营业务收入	79,710.61	99.98	123,745.28	99.97	107,628.94	99.95	68,636.98	99.96
其他业务收入	16.74	0.02	41.83	0.03	49.80	0.05	29.09	0.04
营业收入合计	79,727.35	100.00	123,787.11	100.00	107,678.73	100.00	68,666.06	100.00

公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用关键材料领域。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液和功能性湿电子化学品业务板块销售收入合计占营业收入的比例分别为 99.74%、99.88%、99.31%和 99.17%，是公司营业收入的主要来源。

在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类产品线的布局，报告期内该板块销售收入占营业收入的比例均超过 80%。在功能性湿电子化学品板块，公司在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案，报告期内该板块销售收入总体呈稳步增长。

3、按地区构成分析

报告期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆	76,383.55	95.81	117,172.77	94.66	100,923.72	93.73	64,119.35	93.38
中国大陆以外	3,343.80	4.19	6,614.34	5.34	6,755.01	6.27	4,546.71	6.62
营业收入合计	79,727.35	100.00	123,787.11	100.00	107,678.73	100.00	68,666.06	100.00

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，目前收入主要来自于中国大陆和中国台湾。报告期内，公司持续保持与现有客户积极紧密合作，加大力度开拓中国大陆地区市场，同时海外市场进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上升的趋势。

（二）营业成本

1、营业成本概况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元、%

项 目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	33,693.33	99.95	54,654.71	99.93	49,257.64	99.90	33,563.09	99.92
其他业务成本	16.74	0.05	40.97	0.07	48.46	0.10	26.29	0.08
营业成本合计	33,710.07	100.00	54,695.69	100.00	49,306.10	100.00	33,589.38	100.00

报告期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司主营业务收入匹配。

2、营业成本按产品构成情况

报告期内，公司按产品进行分类的营业成本情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化学机械抛光液	26,218.83	77.78	43,856.29	80.18	39,392.42	79.89	26,489.04	78.86
功能性湿电子化学品	7,317.91	21.71	10,398.96	19.01	9,865.22	20.01	7,074.04	21.06
其他	156.58	0.46	399.46	0.73	-	-	-	-
主营业务成本	33,693.33	99.95	54,654.71	99.93	49,257.64	99.90	33,563.09	99.92
其他业务成本	16.74	0.05	40.97	0.07	48.46	0.10	26.29	0.08
营业成本合计	33,710.07	100.00	54,695.69	100.00	49,306.10	100.00	33,589.38	100.00

报告期内，公司营业成本主要来源于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，与公司营业收入基本匹配。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化学机械抛光液	41,065.32	89.24	63,607.80	92.06	55,729.20	95.47	32,914.43	93.84
功能性湿电子化学品	4,465.44	9.70	5,059.84	7.32	2,563.82	4.39	2,013.04	5.74
其他	486.52	1.06	422.94	0.61	78.28	0.13	146.42	0.42
主营业务毛利	46,017.28	100.00	69,090.57	100.00	58,371.30	100.00	35,073.90	99.99
其他业务毛利	0.00	0.00	0.86	0.00	1.34	0.00	2.80	0.01
营业毛利合计	46,017.28	100.00	69,091.43	100.00	58,372.63	100.00	35,076.68	100.00

报告期内，公司毛利总额分别为 35,076.68 万元、58,372.63 万元、69,091.43 万元和 46,017.28 万元，呈逐年上升趋势。从产品构成来看，公司报告期内的毛

利主要来源于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液贡献较大。

2、毛利率分析

报告期内，公司主要产品的收入结构和毛利率情况如下：

单位：%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
化学机械抛光液	84.39	61.03	86.81	59.19	88.34	58.59	86.51	55.41
功能性湿电子化学品	14.78	37.90	12.49	32.73	11.54	20.63	13.23	22.15
综合毛利率	-	57.72	-	55.81	-	54.21	-	51.08

报告期内，公司综合毛利率稳中有升，主要是由于各主要产品的毛利率整体均有所上升所致。

报告期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司持续推进抛光液全品类产品的开发及客户端导入进程，近年来开发的数只高技术难度、高研发投入的新产品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面系公司与主要客户以美元进行结算，最近两年美元对人民币平均汇率的上升导致化学机械抛光液平均单价上升。2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液板块毛利率进一步提升的主要原因系毛利率相对较高的部分规格抛光液产品收入占比随客户用量提升。

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率分别为 22.15%、20.63%、32.73%和 37.90%，整体呈现波动上升趋势。2022 年度，公司功能性湿电子化学品板块毛利率出现下滑，主要原因一方面系部分原材料采购价格上涨及部分进口原材料汇率变动导致成本上升；另一方面系 2021 年安集集成电路材料基地项目达到预定可使用状态并投入使用，相关生产线生产功能性湿电子化学品，受新增设备调试及客户测试认证进度的影响，投产初期产量较低、固定资产折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体毛利率下降。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率有所回升，主要是由于产品结构变动及宁波安集实施的首发募投项目产量提升带

来平均单位成本下降等共同影响。

报告期内，公司综合毛利率与境内外可比公司对比情况如下：

公司名称	2024 年 1-6 月	2023 年	2022 年	2021 年
Entegris	45.95%	42.50%	42.55%	46.09%
Fujifilm	-	40.06%	39.80%	40.91%
Resonac	22.65%	19.13%	21.76%	23.81%
Merck	59.61%	59.03%	61.65%	62.66%
DuPont	35.86%	35.08%	35.45%	36.57%
上海新阳	39.65%	35.16%	31.35%	35.43%
可比公司平均值	40.74%	38.49%	38.76%	40.91%
发行人	57.72%	55.81%	54.21%	51.08%

注：以上数据来源于可比公司定期报告。

报告期内，公司综合毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务集中于集成电路领域高端半导体材料，专注的细分领域技术、人才、客户等壁垒高，且报告期内收入主要来源于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司整体业务相对宽泛。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用变动及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
销售费用	2,375.79	2.98	4,818.12	3.89	3,426.53	3.18	2,932.86	4.27
管理费用	5,035.13	6.32	8,132.57	6.57	6,850.61	6.36	6,020.03	8.77
研发费用	14,456.52	18.13	23,661.27	19.11	16,136.46	14.99	15,310.78	22.30
财务费用	-793.34	-1.00	-827.18	-0.67	-2,733.50	-2.54	836.63	1.22
合计	21,074.10	26.43	35,784.78	28.91	23,680.09	21.99	25,100.31	36.55

报告期内，公司期间费用占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%、28.91% 和 26.43%，期间费用占比随着营业收入增长整体呈现下降趋势。2022 年度，由于营业收入大幅上升，同时销售费用、管理费用、研发费用等三项期间费用受全球公共卫生事件及当年度股份支付费用减少等因素的影响增长幅度相对较小，且财务费用中汇兑损益的金额受汇率变动影响波动较大，导致期间费用占营业收入

比例下降幅度较大。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
仓储运输	320.95	13.51	524.26	10.88	542.04	15.82	340.77	11.62
差旅费	63.63	2.68	145.53	3.02	78.52	2.29	99.38	3.39
客户端维护费	2.59	0.11	121.75	2.53	203.84	5.95	157.54	5.37
人力成本	728.57	30.67	1,220.51	25.33	1,052.56	30.72	810.32	27.63
股权激励费用	325.10	13.68	459.81	9.54	220.11	6.42	515.29	17.57
样品费	542.72	22.84	1,507.62	31.29	623.79	18.20	441.98	15.07
业务招待费	228.07	9.60	480.34	9.97	297.98	8.70	265.64	9.06
折旧与摊销	85.73	3.61	192.86	4.00	167.75	4.90	175.70	5.99
租金与物业	3.92	0.16	6.59	0.14	3.79	0.11	3.67	0.13
其他	74.53	3.14	158.85	3.30	236.16	6.89	122.58	4.18
合计	2,375.79	100.00	4,818.12	100.00	3,426.53	100.00	2,932.86	100.00

公司销售费用主要包括仓储运输、人力成本、股权激励费用和样品费等。最近三年，公司销售费用逐年上升，主要是以下因素的共同作用所致：（1）随着公司业务规模快速增长，人力成本逐年增加；（2）公司向客户发送样品量增长，导致样品费上升。2024 年 1-6 月，公司销售费用增长主要系人力成本、股权激励费用及因业务及送样活动增加伴随的仓储物流费增长所致。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人力成本	2,116.97	42.04	3,240.39	39.84	2,908.05	42.45	2,351.61	39.06
股权激励费用	1,121.56	22.27	1,057.59	13.00	1,083.06	15.81	1,492.98	24.80
折旧与摊销	722.67	14.35	1,163.28	14.30	852.14	12.44	771.72	12.82
差旅费	60.24	1.20	117.43	1.44	26.84	0.39	51.71	0.86

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租金与物业	21.54	0.43	73.93	0.91	23.69	0.35	57.78	0.96
办公费用	76.09	1.51	217.81	2.68	195.65	2.8	228.19	3.79
水电费	70.90	1.41	136.88	1.68	80.45	1.17	80.60	1.34
外部服务费	685.02	13.60	1,730.99	21.28	1,369.02	19.98	788.79	13.10
业务招待费	115.85	2.30	242.68	2.98	119.33	1.74	85.70	1.42
税金	5.66	0.11	11.32	0.14	11.32	0.17	11.32	0.19
其他	38.62	0.77	140.26	1.72	181.05	2.64	99.64	1.66
合计	5,035.13	100.00	8,132.57	100.00	6,850.61	100.00	6,020.03	100.00

注：税金是指集团内部交易带来的税务成本。

报告期内，公司管理费用主要包括人力成本、股权激励费用、折旧与摊销、外部服务等。最近三年，公司管理费用随着经营规模的增长逐年上升。

2023 年度，发行人管理费用比 2022 年度增加 1,281.96 万元，主要是由于：

（1）随着公司业务规模快速增长，人力成本增加 332.34 万元；（2）公司位于金桥综合保税区的新办公场地投入使用，使得折旧与摊销有所上升。2024 年 1-6 月，公司管理费用增长主要系股权激励费用、人力成本及折旧与摊销增加所致。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人力成本	5,426.14	37.53	8,558.73	36.17	6,886.00	42.67	4,783.84	31.24
股权激励费用	1,138.80	7.88	1,386.11	5.86	1,166.68	7.23	1,658.91	10.83
折旧与摊销	2,971.99	20.56	5,384.34	22.76	3,408.99	21.13	1,498.59	9.79
差旅费	217.90	1.51	429.16	1.81	215.73	1.34	236.10	1.54
租金与物业	40.09	0.28	156.80	0.66	80.63	0.50	67.41	0.44
办公费用	67.72	0.47	144.68	0.61	54.96	0.34	43.03	0.28
水电费	279.74	1.94	618.59	2.61	455.21	2.82	316.92	2.07
物料消耗	3,759.96	26.01	5,136.45	21.71	2,531.34	15.69	5,680.54	37.10
专利费	49.09	0.34	231.05	0.98	244.71	1.52	256.36	1.67
税金	67.07	0.46	233.35	0.99	356.96	2.21	529.42	3.46

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	438.01	3.03	1,382.00	5.84	735.25	4.56	239.67	1.57
合计	14,456.52	100.00	23,661.27	100.00	16,136.46	100.00	15,310.78	100.00

注：税金是指集团内部交易（如委托研发）带来的税务成本。

报告期内，公司研发费用主要由人力成本、物料消耗、折旧与摊销费用、股权激励费用等构成，其中人力成本是公司研发费用最主要的组成部分，有效保证了公司研发团队的稳定。

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司研发费用分别为 15,310.78 万元、16,136.46 万元、23,661.27 万元和 14,456.52 万元，占营业收入的比例分别为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%。2023 年和 2024 年 1-6 月公司研发费用较上年同期大幅增长，主要原因系人力成本、股权激励费用及物料消耗的增长，与公司业务开拓和发展过程中不断开展研发活动和提升研发能力相匹配。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
借款的利息支出	216.61	246.52	44.41	27.72
租赁负债的利息支出	240.11	549.86	628.76	349.08
利息收入	-711.99	-889.19	-271.53	-157.17
汇兑损益	-568.30	-780.72	-3,171.68	580.71
其他财务费用	30.23	46.35	36.53	36.30
合计	-793.34	-827.18	-2,733.50	836.63

公司财务费用主要包括利息支出、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司财务费用分别为 836.63 万元、-2,733.50 万元、-827.18 万元和-793.34 万元。

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较高。报告期内，公司汇兑损益变动主要系美元汇率波动所致。

（五）其他利润表项目分析

1、其他收益

报告期内，公司的其他收益分别为 2,647.34 万元、1,190.79 万元、10,430.16 万元和 1,870.36 万元，主要系与公司日常经营活动有关的政府补助。2023 年其他收益金额较高，主要系“图形化工艺用材料产品开发”、“研磨抛光清洗液的研发与工艺应用”等政府补助项目通过验收所致。

2、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益具体如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
交易性金融资产	-666.03	-886.86	-2,538.04	97.05
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	-	18.88	-	100.95
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	-58.34	1,743.83	1,506.17	680.00
合计	-724.36	875.85	-1,031.87	878.00

报告期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1,031.87 万元、875.85 万元和-724.36 万元。报告期内，公司公允价值变动收益大幅波动，主要是由于公司参与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板的战略配售而持有的交易性金融资产产生公允价值变动所致。

3、营业外支出

报告期内，发行人营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动资产毁损报废损失	22.54	-	-	-
对外捐赠	22.87	-	4.00	55.16
违约损失	-	-	-	80.37
其他	6.84	3.64	0.59	0.19
合计	52.25	3.64	4.59	135.72

公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠支出，违约

损失主要为公司解除一项租赁合同而无法收回的履约保证金。

（六）非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，发行人非经常性损益发生额如下表所示：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动资产处置损益	-22.54	-69.09	-5.53	-25.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	688.59	8,791.07	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		-	1,190.79	2,647.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和交易性金融负债产生的损益	-741.15	1,752.08	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-	-927.27	1,783.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27.51	3.20	-4.59	-135.72
小计	-102.61	10,477.26	253.40	4,269.00
所得税影响额	18.00	-2,403.98	-155.09	-871.35
合计	-84.61	8,073.28	98.32	3,397.65

报告期内，公司的非经常性损益主要来源于计入当期损益的政府补助及持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。

七、现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	19,529.40	33,623.47	23,912.21	6,110.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,580.60	-31,581.63	-25,654.19	-3,288.80

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
筹资活动产生的现金流量净额	3,050.02	17,492.34	625.58	-3,181.48
现金及现金等价物净增加额	11,423.50	19,854.38	-108.76	-519.16
期末现金及现金等价物余额	64,179.88	52,756.38	32,902.00	33,010.76

（一）经营活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金	75,842.17	126,158.29	105,461.95	59,309.24
收到的税费返还	435.95	1,052.31	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,546.38	2,867.77	2,181.88	10,359.57
经营活动现金流入小计	77,824.50	130,078.36	107,643.83	69,668.82
购买商品、接受劳务支付的现金	39,952.71	68,554.71	62,603.58	47,426.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,320.01	16,885.54	12,779.86	9,549.36
支付的各项税费	2,467.66	5,211.07	4,162.80	2,798.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,554.71	5,803.58	4,185.38	3,783.73
经营活动现金流出小计	58,295.10	96,454.89	83,731.62	63,558.24
经营活动产生的现金流量净额	19,529.40	33,623.47	23,912.21	6,110.58

报告期各期末，随着生产经营规模的扩大，公司经营活动产生的现金流量净额整体呈上升趋势。

（二）投资活动产生的现金流量

发行人报告期内投资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收回投资收到的现金	16,000.00	47,871.77	63,045.63	139,658.92
取得投资收益所收到的现金	52.54	876.22	211.60	3,670.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	14.06
收到其他与投资活动有关的现金	710.62	889.19	271.53	570.31
投资活动现金流入小计	16,763.16	49,637.18	63,528.76	143,914.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,275.71	33,791.78	19,628.65	24,111.64
投资支付的现金	14,000.00	43,000.00	66,120.94	123,091.43
取得子公司及其他营业单位支付	17.60	4,427.02	3,433.35	-

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	50.45	-	-	-
投资活动现金流出小计	28,343.76	81,218.80	89,182.95	147,203.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,580.60	-31,581.63	-25,654.19	-3,288.80

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,288.80 万元、-25,654.19 万元、-31,581.63 万元和-11,580.60 万元。

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系 2019 年公司首次公开发行股票及 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司募投项目持续建设，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金处于较高水平。

（三）筹资活动产生的现金流量

发行人报告期内筹资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
吸收投资收到的现金	2,756.88	21,425.21	884.89	725.49
取得借款收到的现金	5,700.00	7,800.39	6,000.00	2,910.41
筹资活动现金流入小计	8,456.88	29,225.60	6,884.89	3,635.90
偿还债务支付的现金	209.16	3,025.75	1,580.55	3,466.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,653.41	3,431.00	1,742.15	1,635.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,544.30	5,276.51	2,936.61	1,715.25
筹资活动现金流出小计	5,406.86	11,733.26	6,259.31	6,817.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,050.02	17,492.34	625.58	-3,181.48

2021 年、2022 年和 2024 年 1-6 月，发行人筹资活动现金流入主要为取得银行借款等。筹资活动现金流出主要为偿还银行借款、分配股利等。2023 年，发行人筹资活动现金流入主要为向特定对象发行股票收到的募集资金。

综上所述，公司现金流量变化情况与报告期内公司整体经营状况相适应。

八、资本性支出分析

（一）报告期重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 24,111.64 万元、19,628.65 万元、33,791.78 万元和 14,275.71 万元，主要用于支付厂房工程款项、购买生产设备等。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书摘要签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出，具体情况详见本募集说明书摘要“第五节 本次募集资金运用”。

九、技术创新分析

公司核心技术先进性、正在从事的研发项目及进展情况以及保持持续技术创新的机制和安排，详见募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“九、核心技术情况”。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本募集说明书摘要签署日，公司不存在重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

十一、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，是公司深化在高端半导体材料领域的业务布局、完善并延伸产业链的重要举措。本次发行不会导致公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

公司本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，并基于现有业务和核心技术平台，将有助于进一步提升公司科技创新水平，增强公司的综合竞争实力和核心技术及业务优势，为公司实现成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 83,050 万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	上海安集集成电路材料基地项目	38,000.00	34,850.00
2	上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	9,000.00	9,000.00
3	宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目	8,000.00	6,000.00
4	安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	11,000.00	11,000.00
5	补充流动资金	24,000.00	22,200.00
合计		90,000.00	83,050.00

注 1：上述拟使用募集资金投入金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 1,800.00 万元；

注 2：本次募投项目“上海安集集成电路材料基地项目”中刻蚀液生产线拟使用自有资金投资建设，不涉及使用本次募集资金。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目实施的必要性与可行性分析

（一）项目实施的必要性

1、顺应全球半导体产业长期发展趋势，把握半导体材料国产替代的良好机遇，提升产业链自主可控供应能力

当前，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。根据 WSTS 统计及预测，全球半导体市场规

模已从 2000 年的 2,044 亿美元增长至 2022 年的 5,741 亿美元；2023 年全球半导体市场规模下降 8.2%至 5,268.85 亿美元，而 2024 年和 2025 年全球半导体市场规模将分别增长至 6,112.31 亿美元和 6,873.80 亿美元，同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。

由于技术壁垒高、国内起步较晚，目前全球半导体材料供应链依然由日本、欧美等海外企业占据绝对主导地位，而国内半导体材料整体国产化率较低，特别是 12 英寸高端领域国产替代需求极为迫切。在当前半导体产业环境和国际形势下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增加了半导体供应链的不确定性，供应链安全成为本土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次募集资金投资项目的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延伸产业链，及时把握集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的良好机遇，同时助力进一步提升关键材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保产业链供应链稳定具有重要意义。

2、深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，加强和保障公司产品及上游关键原料的供应能力，进一步提升公司生产制造能力和技术研发水平

公司作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，始终致力于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键半导体材料的空白，并成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列平台。公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，持续深化在高端半导体材料领域的业务布局，横向拓宽产品品类，纵向延伸产业链，不断加深加快关键原材料的自主可控进程。

本次募投项目中，“上海安集集成电路材料基地项目”旨在建设集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、新型配方工艺化学品及配套产品的规模化生产线，拓宽公司产品品类，同时建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等核心原材料供应能力，提升国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本项目系“上海化学工业区 2023 年重点产业项目”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、生产、质量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，并且具有化工产品生产的条件和资质，满足了公司进一步拓展产品

布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集生产控制、质量管理、仓储等于一体的自动化、信息化管理系统，进一步提升智能制造水平和运营管理效率。

“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目”旨在提升公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等产品产能，并新增电子级添加剂生产能力，有助于加强和保障相关产品及上游关键原材料供应，并进一步推进公司上海金桥、宁波北仑、上海化工区三大生产制造基地差异化布局和协同发展，助力公司产品战略的实施和多元化布局，同时满足了客户关于供应商应设立多个生产基地以规避风险的要求，对于确保产业链供应链稳定具有重要意义。

“安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目”拟在公司上海金桥基地购置多套研发设备，进一步提升公司研发能力，为公司持续科技创新提供重要支撑。

3、增强公司资金实力，优化财务结构，提升抗风险能力

2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司经营规模持续扩大，实现营业收入分别为 68,666.06 万元、107,678.73 万元、123,787.11 万元，复合增长率达到 34.27%。随着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模均同步增长，对营运资金的需求不断增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。未来，随着公司现有产能的释放和新增产能的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于推进公司在生产及研发等经营活动中的稳步投入，为公司经营规模的持续提升提供有力的流动资金保障。

本次募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，进一步优化公司的财务结构，巩固和提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

（二）项目实施的可行性

1、国家及地方政府大力支持集成电路产业链发展

半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，已经成为全球各国在高科技竞争中的战略制高点，全球主要国家和地区相继出台半导体产业扶持政策。近年来，

为了加快推进我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程，国家制定了一系列产业政策，对于提升中国集成电路产业链关键配套材料的本土供应能力起到了重要作用。在地方政策层面，上海和宁波也发布了一系列政策大力支持集成电路产业高质量发展，打造集成电路产业集聚区和材料基地。2020年12月，上海化工区电子化学品专区揭牌成立，重点发展光刻胶及配套材料、电子特气、湿电子化学品等三大类产品，打造电子化学品研发试验基地、生产基地、物流存储基地。到2025年，力争专区各类产品为上海集成电路产业的电子化学品品种配套率达到70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到2030年，实现本土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率超过90%，成为具有国际影响力的电子化学品基地。

化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂作为应用于集成电路制造和先进封装领域的关键材料，属于《战略性新兴产业分类（2018）》列示的重点产品，是国家重点鼓励、支持的战略性新兴产业。国家及当地政府对集成电路产业链的高度重视和政策支持为本次募投项目的实施提供了良好的政策环境。

2、公司深耕高端半导体材料领域，为国产高端半导体材料发展作出积极贡献并持续突破，深厚的技术积累、持续的研发投入、高效的产品转化和优秀的人才队伍为项目实施提供了必要支撑

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，并在报告期内拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。公司在打破特定领域高端材料100%进口局面，填补国内技术空白的基础上，带动、引领半导体材料产业链的快速发展。

公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产品组合及解决方案。公司坚持市场和客户导向的研发策略，得益于有竞争力的商业模式及优质的客户基础，公司产品研发效率高且具有针对性，产品转化率高，近年来持续、及时推出了符合市场和客户需求的新产品。深厚的技术积累、持续

的研发投入、高效的产品转化为项目的实施提供了技术支撑。

公司高度重视研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发积累，组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。公司核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司核心管理团队也在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司管理等方面拥有丰富经验。公司高素质的员工队伍为募投项目的实施提供了人才基础。

3、半导体材料市场前景及国产替代空间广阔，公司与行业领先客户长期稳定合作，多款产品开发进展顺利，为募投项目产能消化提供了市场保障

受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料市场规模保持增长态势，且制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成技术需要更多的工艺步骤，带来更高的晶圆制造材料和封装材料消耗需求。根据 SEMI，2022 年全球半导体材料市场销售额增长 8.9%，达到 727 亿美元，超过了 2021 年创下的 668 亿美元的前一市场高点。2023 年，受整个半导体行业环境影响，全球半导体材料市场销售额下降 8.2%至 667 亿美元。从材料大类来看，2023 年全球晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿美元和 252 亿美元，占全球半导体材料销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区分布来看，中国台湾和中国大陆是全球前两大半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿美元和 131 亿美元，占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全球唯一实现半导体材料销售额同比增长的地区。

本次募投产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下游晶圆产能增加、先进封装技术快速发展将带动公司产品需求增长。根据 SEMI 预测，全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年实现 7%的增长，达到每月晶圆产能 3,370 万片的历史新高（以 8 英寸当量计算）；从地区来看，中国大陆芯片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1,010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定律时代的关键技术，根据 Yole 预测，全球先进封装市场规模将从 2023 年的 378 亿美元增长至 2029 年的 695 亿美元，期间的复合年增长率为 10.7%，得益于移

动和消费类、电信和基础设施以及汽车等终端市场需求的强劲增长，以及高性能计算和生成式人工智能等大趋势的推动，先进封装市场发展迅猛。此外，受益于国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商技术的突破和成熟、国产化的成本优势等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。

公司持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。在“立足中国，服务全球”的战略定位下，公司持续保持与现有客户积极紧密合作，加大力度开拓中国大陆地区市场，客户用量及客户数量稳步提升，同时海外市场进一步拓展。由于公司产品准入门槛高、认证时间长，一旦成为下游集成电路领域客户的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系。公司现有优质客户资源以及多款产品开发进展顺利，为本次募投项目产品的市场推广和客户导入提供了保障。

三、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景

（一）上海安集集成电路材料基地项目

1、项目概况

公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地项目，项目建成后新增 8,000 吨刻蚀液、3,400 吨新型配方工艺化学品及配套产品（电镀液及添加剂）、1,200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料生产能力。其中，刻蚀液生产线拟使用自有资金投资建设，不涉及使用本次募集资金。

2、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司全资子公司安集电子材料，项目总投资 38,000.00 万元，拟使用募集资金投入 34,850.00 万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	土地购置费	3,700.00	是	3,700.00
2	建筑工程及其他费用	21,440.00	是	21,440.00
3	设备购置及安装费	11,060.00	是	8,060.00
4	预备费	1,625.00	否	1,475.00
5	铺底流动资金	175.00	否	175.00
合计		38,000.00	-	34,850.00

3、整体进度计划及预计实施时间

本项目预计建设期为3年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第1年				建设期第2年				建设期第3年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目设计、施工招标与施工准备												
土建主体结构施工及配套建设												
设备采购、安装及调试												
人员招募及培训												
竣工验收交付使用												

4、项目经济效益

鉴于本募投项目中刻蚀液生产线拟使用自有资金投资建设，不涉及本次募集资金，本次募投项目经济效益测算未考虑刻蚀液产品产生的相关效益，本次募投项目经济效益具体如下：

本项目税后内部收益率为11.65%，静态投资回收期为10.58年。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目拟新增电镀液及添加剂等产品产能和新增化学机械抛光液用高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等核心原材料产能，营业收入=Σ销量×单价。对于产品，销量根据目标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现有其他品类功能性湿电子化学品定价原则及趋势确定；对于原材料，销量根据公司生产产品对应原材料各年自用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考市场采购价格确定。

（2）税金及附加预测

本项目销项税按营业收入的13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的13%估算，增值税为销项税与进项税之差；城市维护建设税按照应缴纳增值税的5%估算；教育费附加按照应缴纳增值税的3%估算，地方教育费附加按照应缴纳增值税的2%估算；本项目效益测算期为10年，自项目公司实现盈利开始按照25%的税率估算企业所得税。

（3）总成本费用预测

本项目总成本费用包括原辅材料费、燃料动力费、固定资产折旧、摊销、职工薪酬、其他费用等。

1) 原辅材料费和燃料动力费：本项目外购原材料成本按照耗用量和采购价格测算，辅料和燃料动力费根据生产预计所需前述成本占收入的比例确定。

2) 折旧与摊销：本项目新增土地使用权摊销年限取 50 年；新增固定资产采用分类直线折旧方法计算，新增机器设备折旧年限取 10 年，房屋建筑物折旧年限取 20 年，均无残值。

3) 职工薪酬：本项目新增定员包括管理人员、生产人员、技术人员、工程及设备维护人员和仓库人员等，薪酬结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地各类员工的工资水平确定。

4) 其他费用：本项目其他费用主要包括其他制造费用和其他期间费用（不包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

本项目选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本项目土地的《不动产权证书》。

本项目已取得上海化学工业区管理委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》，已取得上海市生态环境局出具的《关于上海安集集成电路材料基地项目环境影响报告书的审批意见》。

（二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目

1、项目概况

公司拟在上海安集集成电路材料基地购置相关软硬件设施，搭建集生产控制、质量管理、仓储等于一体的自动化、信息化管理系统，提升智能制造水平和运营管理效率。

2、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司全资子公司安集电子材料，项目总投资 9,000.00 万元，拟使用募集资金投入 9,000.00 万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额 (万元)	是否属于资 本性支出	拟使用募集资金投入 金额(万元)
1	MES（制造执行系统）系统	800.00	是	800.00
2	DCS（集散控制系统）系统	2,000.00	是	2,000.00
3	质量管理软件	1,000.00	是	1,000.00
4	工艺优化软件	1,000.00	是	1,000.00
5	弱电、机房服务器及其他配套	2,200.00	是	2,200.00
6	立体仓库	2,000.00	是	2,000.00
合计		9,000.00	-	9,000.00

3、整体进度计划及预计实施时间

本项目预计建设期为 3 年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
弱电和机房服务器及其他 配套设计、招标及实施												
DCS（集散控制系统）设计、 招标、实施及上线												
MES（制造执行系统）设计、 招标、实施及上线												
工艺优化软件设计、招标、 实施及上线												
质量管理软件设计、招标、 实施及上线												
立体仓库设计、招标及实施												

4、项目经济效益

本项目旨在提高公司的自动化和信息化程度，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

本项目将利用“上海安集集成电路材料基地项目”土地，安集电子材料已取得该土地的《不动产权证书》。

本项目已取得上海化学工业区管理委员会出具的《上海市企业投资项目备案

证明》。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。

（三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目

1、项目概况

公司拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路 79 号的已建厂房，建设宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目，本次募投项目建成后将新增 10,000 吨光刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5,000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生产能力。

2、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司全资子公司宁波安集，项目总投资 8,000.00 万元，拟使用募集资金投入 6,000.00 万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	厂务系统及配套	700.00	是	700.00
2	设备及安装	6,600.00	是	4,700.00
3	预备费	365.00	否	270.00
4	铺底流动资金	335.00	否	330.00
合计		8,000.00	-	6,000.00

3、整体进度计划及预计实施时间

本项目预计建设期为 3 年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
厂务系统及配套建设												
生产设备、分析测试设备和环保设备采购、安装及调试												

4、项目经济效益

本项目税后内部收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电子级添加剂等核心原材料产能，营业收入=Σ销量×单价。对于产品，销量根据目标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现有其他品类功能性湿电子化学品定价原则及趋势确定；对于原材料，销量根据公司生产产品对应原材料各年自用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考市场采购价格确定。

（2）税金及附加预测

本项目销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 13%估算，增值税为销项税与进项税之差；城市维护建设税按照应缴纳增值税的 7%估算；教育费附加按照应缴纳增值税的 3%估算，地方教育费附加按照应缴纳增值税的 2%估算；本项目效益测算期为 10 年，自项目公司实现盈利开始按照 25%的税率估算企业所得税。

（3）总成本费用预测

本项目总成本费用包括原辅材料费、燃料动力费、固定资产折旧、摊销、职工薪酬、其他费用等。

1) 原辅材料费和燃料动力费：本项目外购原材料成本按照耗用量和采购价格测算，辅料和燃料动力费根据生产预计所需前述成本占收入的比例确定。

2) 固定资产折旧：本项目采用分类直线折旧方法计算。新增机器设备折旧年限取 10 年，均无残值。

3) 职工薪酬：本项目新增定员包括生产人员，薪酬结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地工资水平确定。

4) 其他费用：本项目其他费用主要包括其他制造费用和其他期间费用（不包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

公司拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路 79 号的已建厂房实施本项目，宁波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工

业用地/工业用房”。

本项目已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，已取得宁波市生态环境局出具的《关于宁波安集电子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目环境影响报告书的批复》。

（四）安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目

1、项目概况

本项目拟在公司上海金桥基地购置多套研发设备，进一步提升公司研发能力，为公司持续科技创新提供重要支撑。

2、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司，项目总投资 11,000.00 万元，拟使用募集资金投入 11,000.00 万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额 (万元)	是否属于资本性 支出	拟使用募集资金投入 金额(万元)
1	研发检测类设备	8,000.00	是	8,000.00
2	抛光机台	2,000.00	是	2,000.00
3	实验室环境升级	1,000.00	是	1,000.00
合计		11,000.00	-	11,000.00

3、整体进度计划及预计实施时间

本项目预计建设期为 3 年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
实验室环境升级建设												
抛光机台采购、安装及调试												
研发检测类设备采购、安装及调试												

4、项目经济效益

本项目旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

5、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租赁房屋实施本项目。

本项目已取得上海金桥经济技术开发区管委会出具的《上海市外商投资项目备案证明》。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。

（五）补充流动资金

1、本次补充流动资金的原因及规模的合理性

报告期内，公司经营规模持续扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率为 34.27%。随着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模均同步增长，对营运资金的需求不断增加。此外，半导体材料行业具有技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点，公司根据行业发展趋势和下游客户需求，有针对性地进行前瞻性研究和产品研发，研发投入持续保持在较高水平，2021 年至 2023 年累计研发费用占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司产品与不断推进的集成电路制造及先进封装技术同步的关键。未来，随着公司现有产能的释放和新增产能的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于推进公司在生产及研发等经营活动中的稳步投入，为公司经营规模的持续提升提供有力的流动资金保障。

公司综合考虑了业务规模、业务增长情况、货币资金余额、资产负债率、未来资本性和流动性资金需求等因素，拟使用募集资金 22,200.00 万元用于补充流动资金，以增强公司的资金实力，巩固和提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及补充流动资金占募集资金的比例

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 83,050.00 万元（含本数），其中上海安集集成电路材料基地项目拟使用募集资金 34,850.00 万元（其中预备费 1,475.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上

海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目拟使用募集资金 9,000.00 万元，安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目拟使用募集资金 11,000.00 万元，宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目拟使用募集资金 6,000.00 万元（其中预备费 270.00 万元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金项目拟使用募集资金 22,200.00 万元。上述投资构成中，预备费、铺底流动资金等非资本性支出和补充流动资金合计投入为 24,450.00 万元，占本次募集资金总额的 29.44%，未超过 30%。

四、本次募集资金用于拓展新业务、新产品的说明

（一）本次募集资金投资项目与公司主营业务和发展战略的关系

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，并在报告期内拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司通过自建、合作等多种方式，持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，以优化产品性能及成本结构，提升产品竞争力，保障长期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新产品的技术可行性。

本次募集资金投资项目建成后，一方面，将提升刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现有产品品类生产能力，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等产品品类产能，公司将在现有量产产品品类基础上横向拓宽产品品类，进一步丰富产品系列，为国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的关键半导体材料，有助于支持和保障国内集成电路产业链发展及供应链稳定。另一方面，将新增纳米磨料、电子级添加剂等关键原材料产能，实现公司核心原材料的自主可控供应，有助于提升公司产品供应的可靠性和竞争力。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于加强和保障公司产品及上游关键原料的供应能力，深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延伸产业链，巩固并提升公司行业地位，从而进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司及

全体股东利益。

（二）本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备及可行性

1、人员储备

公司高度重视研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产业化实践和积累，组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员 264 人，占公司总人数的比例为 50.09%；公司研发人员中，博士学历 38 人、硕士学历 50 人、本科学历 138 人，本科及以上学历占比 85.61%。公司核心管理团队在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司管理等方面拥有丰富经验，为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角；核心技术人员带领的核心技术团队在化学、材料化学、材料工程等专业领域深耕并积累了数十年的丰富行业经验和先进技术，为募投项目的实施提供了人才基础。同时，本次募投项目实施过程中，公司将持续引进各类人才，以进一步满足募投项目实施需要。

2、技术储备

公司始终围绕液体与固体衬底表面的微观处理技术和高端化学品配方核心技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建了“化学机械抛光液-全品类产品矩阵”、“功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局”、“电镀液及其添加剂-强化及提升电镀高端产品系列战略供应”三大具有核心竞争力的技术平台。同时，公司基于长期实践运用对高端纳米磨料及电子级添加剂等关键原材料有着深刻的理解并长期投入，研发经历了实验室小试、中试放大及工艺优化等阶段，掌握了高端纳米磨料制备技术、电子级添加剂纯化技术等核心工艺技术，通过中试放大研究了放大生产关键工艺参数及其放大路径，为进一步规模化生产奠定了坚实的技术基础。

3、市场储备

本次募投产品及募投原材料对应产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下游晶圆产能增加、先进封装技术快速发展将带动公司产品需求增长。同时，在当前国家相关产业政策大力支持、高端半导体材料国产替代及产业链供应链自主可控需求迫切等有利条件下，公司募投产品国产替代需求较大。公司将基

于与行业领先客户长期稳定的合作关系及联合开发经验，持续推进公司产品向更多应用领域、更多客户的测试认证，并将持续保持研发投入，不断提升研发水平，保持公司产品的市场竞争力。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于加强和保障公司产品及上游关键原料的供应能力，深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并延伸产业链，具有良好的市场发展前景和经济效益。

本次募集资金投资项目的顺利实施，将扩大生产规模，拓宽产品品类，进一步提升公司生产制造和技术研发水平，有助于扩大公司市场份额，巩固并提升公司行业地位，从而进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，公司综合实力和竞争力将进一步增强，有利于公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

六、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于

集成电路制造和先进封装领域。公司产品作为新一代信息技术产业用材料，属于战略性新兴产业中新一代信息技术产业和新材料产业的交叉领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，公司产品属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。

本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，其中“上海安集集成电路材料基地项目”旨在建设集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、新型配方工艺化学品及配套产品的规模化生产线，拓宽公司产品品类，同时建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等核心原材料供应能力，提升国产高端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集生产控制、质量管理、仓储等于一体的自动化、信息化管理系统，进一步提升智能制造水平和运营管理效率；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目”旨在提升公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等产品产能，并新增电子级添加剂生产能力，有助于加强和保障相关产品及上游关键原材料供应；“安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目”旨在进一步提升公司研发能力，为公司持续科技创新提供重要支撑；“补充流动资金”项目主要用于满足公司未来生产经营发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要支撑。本次募集资金未直接或变相用于类金融业务。

本次募集资金投资项目的顺利实施，将扩大生产规模，拓宽产品品类，进一步提升公司生产制造和技术研发水平，有助于扩大公司市场份额，巩固并提升公司行业地位，从而进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，为公司实现成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

第六节 备查文件

- 一、发行人最近三年财务报告及审计报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

